



2026年3月期 決算説明

芝浦メカトロニクス株式会社

2026年5月13日

Contents

- 01 2026年3月期 連結決算概要**
- 02 2027年3月期 連結業績予想**
- 03 新中期経営計画（2026-2028年度）**

01

2026年3月期 連結決算概要

業績サマリー

■ 売上高・利益

- 営業利益、経常利益は4年連続過去最高益を更新
- 前年比 増収増益

売上高 880億円（9%増）、営業利益 153億円（8%増）

SPE分野が順調に推移し増加、特に半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加。

■ 受注高

- 半導体前工程は順調に推移、半導体後工程は大幅増加
受注高877億円（26%増）

半導体前工程ではロジック/ファウンドリ向け装置が順調に推移。

半導体後工程では生成AI需要に牽引され、先端パッケージ向け装置が前年度を大幅に上回る水準で推移。

■ 受注残高

- 2026年3月末 483億円

■ 配当

- 期末配当は60円を予定（株式分割前換算300円）

※2026年3月1日を効力発生日として1株につき5株の割合で株式分割を実施。

業績結果（対前年）

* SPE：半導体前・後工程装置

FPD：FPD前・後工程装置

(億円)	2024年度	2025年度			対前年増減率
		上期	下期	年度	
売上高	809	423	457	880	+9%
営業利益	141	76	77	153	+8%
ROS	17.5%	17.9%	16.8%	17.3%	-0.2pt
経常利益	140	74	75	149	+7%
当期純利益	103	53	59	112	+8%
ROE	24.0%	—	—	21.7%	-2.3pt
受注高	698	412	465	877	+26%
FCF	38	-42	7	-35	-73億円

■ 売上高

前年比9%増収（809億円 ⇒ 880億円）

- SPE分野が増加、特に半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加。

■ 営業利益

前年比8%増益（141億円 ⇒ 153億円）

- SPE分野の売上増加により増益。

■ 受注高

前年比26%増加（698億円 ⇒ 877億円）

- 半導体前工程は前年度から順調に推移、半導体後工程は好調であった前年度を大幅に上回る水準で推移、SPE分野全体で前年度に比べ増加。

セグメント別業績結果（対前年）①

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

■ ファインメカトロニクス部門

➤ 売上高 前年比 4%増（504億円 ⇒ 522億円）

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け装置が順調な一方、マスク向け装置、パワーデバイス向け装置が低調で装置売上高減少。保守・サービス関係が寄与し、全体では前年度に比べ増加。

FPD前工程では、低調で減少。

➤ セグメント利益 前年比 9%減（89億円 ⇒ 81億円）

装置売上高減少、成長投資に伴う販売費及び一般管理費の増加などにより減益。

➤ 受注高 前年比 17%増（453億円 ⇒ 528億円）

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け装置が順調に推移。保守・サービス関係が寄与し、前年度に比べ増加。

FPD前工程では、前年度に比べ増加。

セグメント別業績結果（対前年）②

■メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- 売上高 前年比 38%増（228億円 ⇒ 314億円）
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移し前年度に比べ大幅増加。
FPD後工程及び真空応用装置では、低調で減少。
- セグメント利益 前年比 68%増（47億円 ⇒ 78億円）
半導体後工程の売上増加により大幅増益。
- 受注高 前年比 73%増（177億円 ⇒ 305億円）
半導体後工程では、生成AI用GPUの旺盛な需要の継続を受け、先端パッケージ向け装置が大幅増加。
FPD後工程及び真空応用装置では、市況の影響を受け低調に推移。

業績結果（対前回予想）

》 売上高、利益とも想定内の業績結果

*1: 2026年2月公表

(億円)	2025年度		
	前回予想 *1	実績	対前回予想 増減率
売上高	880	880	±0%
営業利益	150	153	+1.7%
ROS	17.0%	17.3%	+0.3pt
経常利益	147	149	+1.7%
当期純利益	108	112	+3.4%

■ 売上高

前回予想比±0%（880億円 ⇒ 880億円）

■ 営業利益

前回予想比1.7%増益（150億円 ⇒ 153億円）

■ 当期純利益

前回予想比3.4%増益（108億円 ⇒ 112億円）

配当

当社は、連結配当性向をおおむね35%を目途としています。

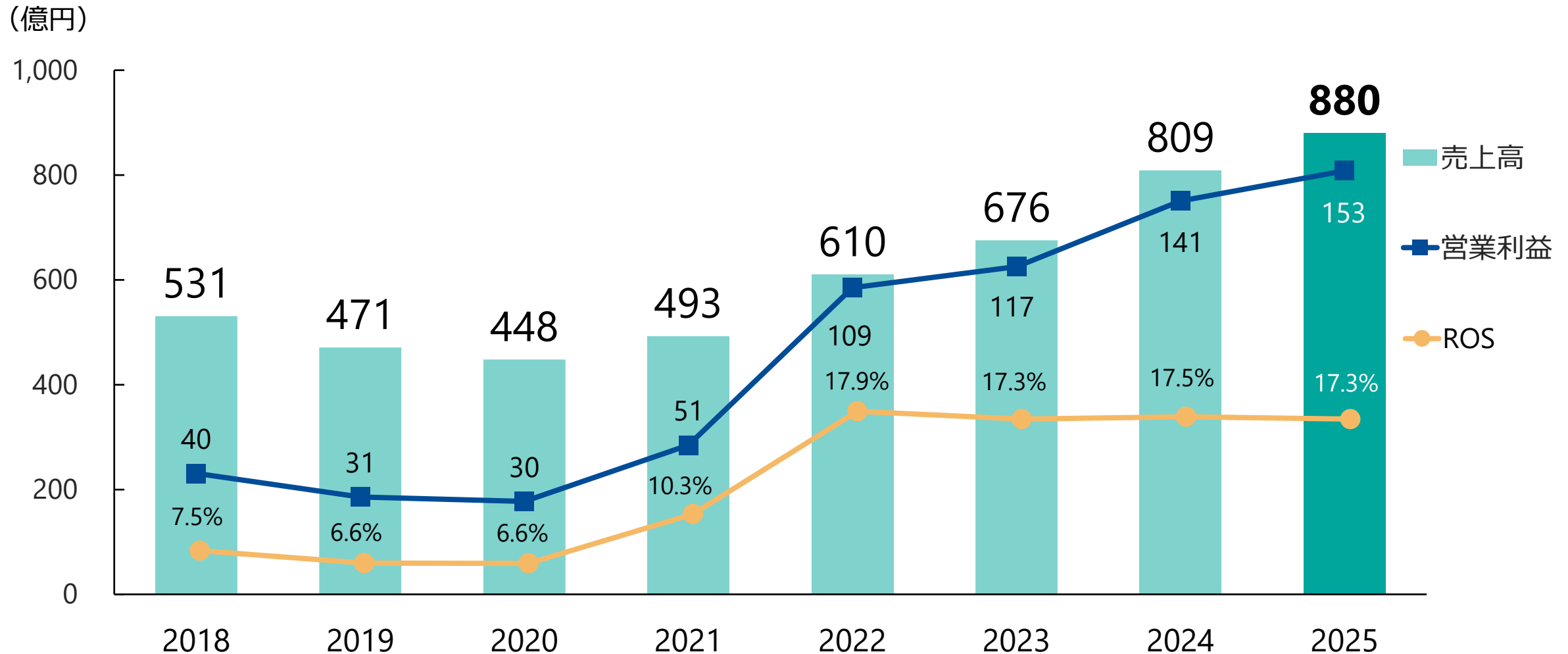
当期純利益が前回予想を上回ったため、期末配当は前回予想から2円増配の60円を予定しています。（連結配当性向35.2%）

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
2026年3月期 (株式分割前換算)	0円	60円 (300円)	60円 (300円)
2026年3月期 (前回26年2月予想) (株式分割前換算)	0円	58円 (290円)	58円 (290円)
2026年3月期 (前回25年11月予想)	0円	238円	238円
2026年3月期 (期初予想)	0円	200円	200円

※2026年3月1日を効力発生日として1株につき5株の割合で株式分割を実施

売上高・利益・ROS

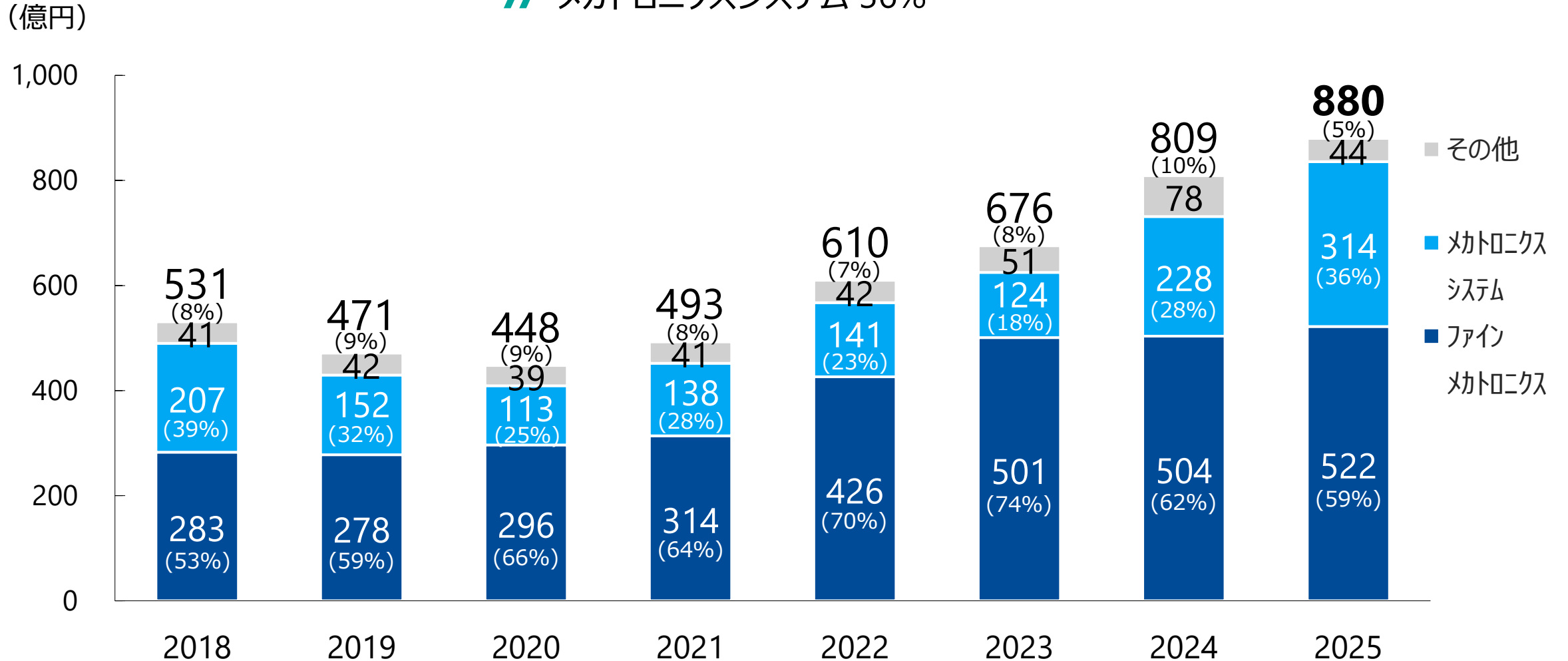
ROS 17.3%



セグメント別売上高

- 》 ファインメカトロニクス 59%
- 》 メカトロニクスシステム 36%

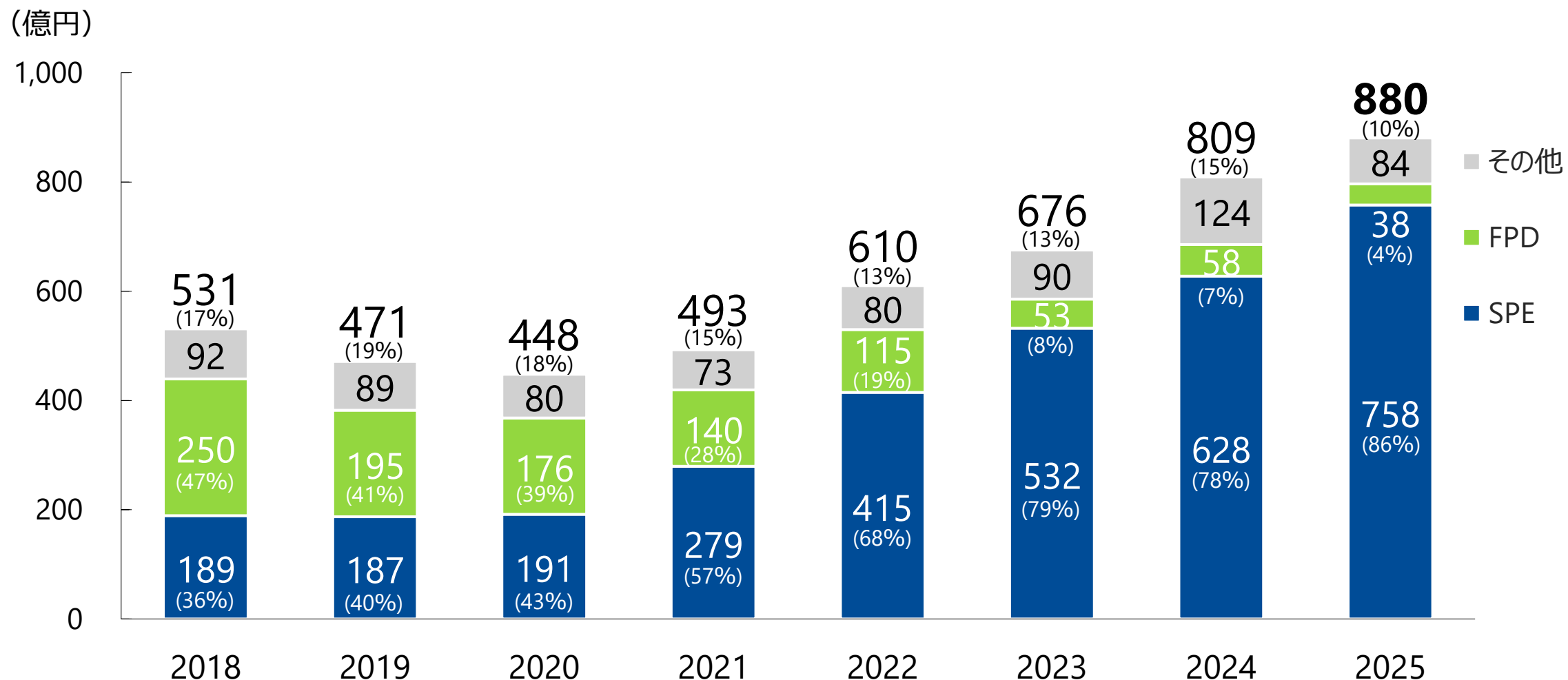
* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



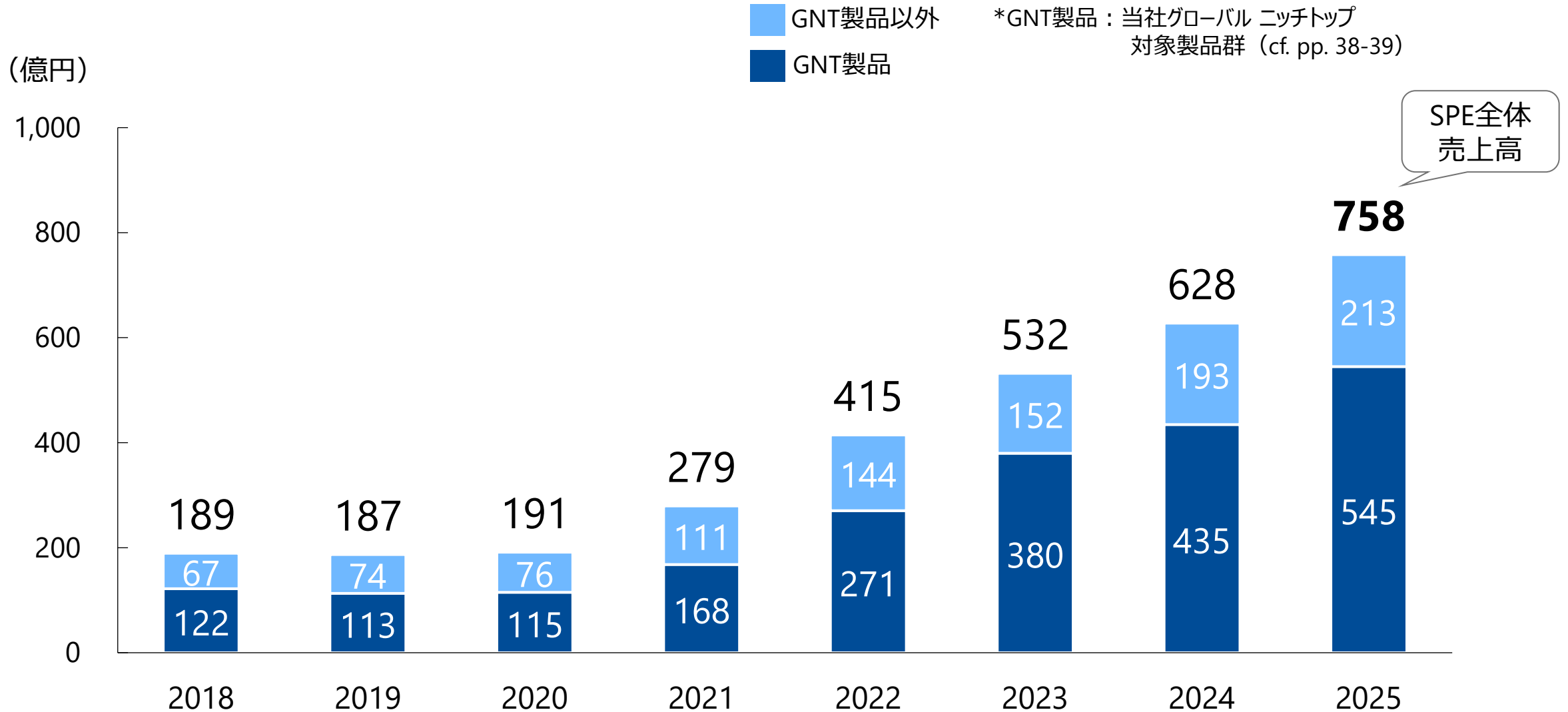
分野別売上高

» SPE分野 86%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

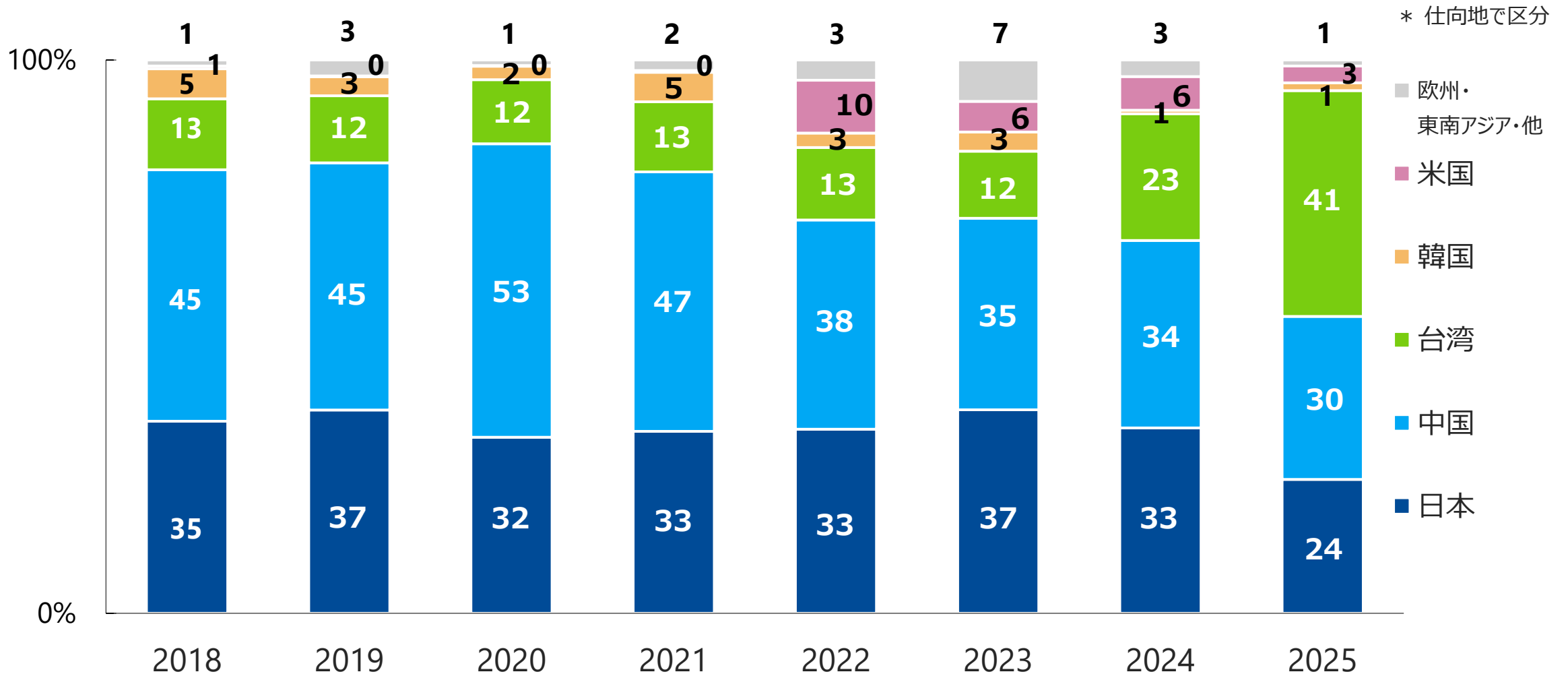


SPE分野売上高



地域別売上高比率

海外向け76%（台湾41%、中国30%）

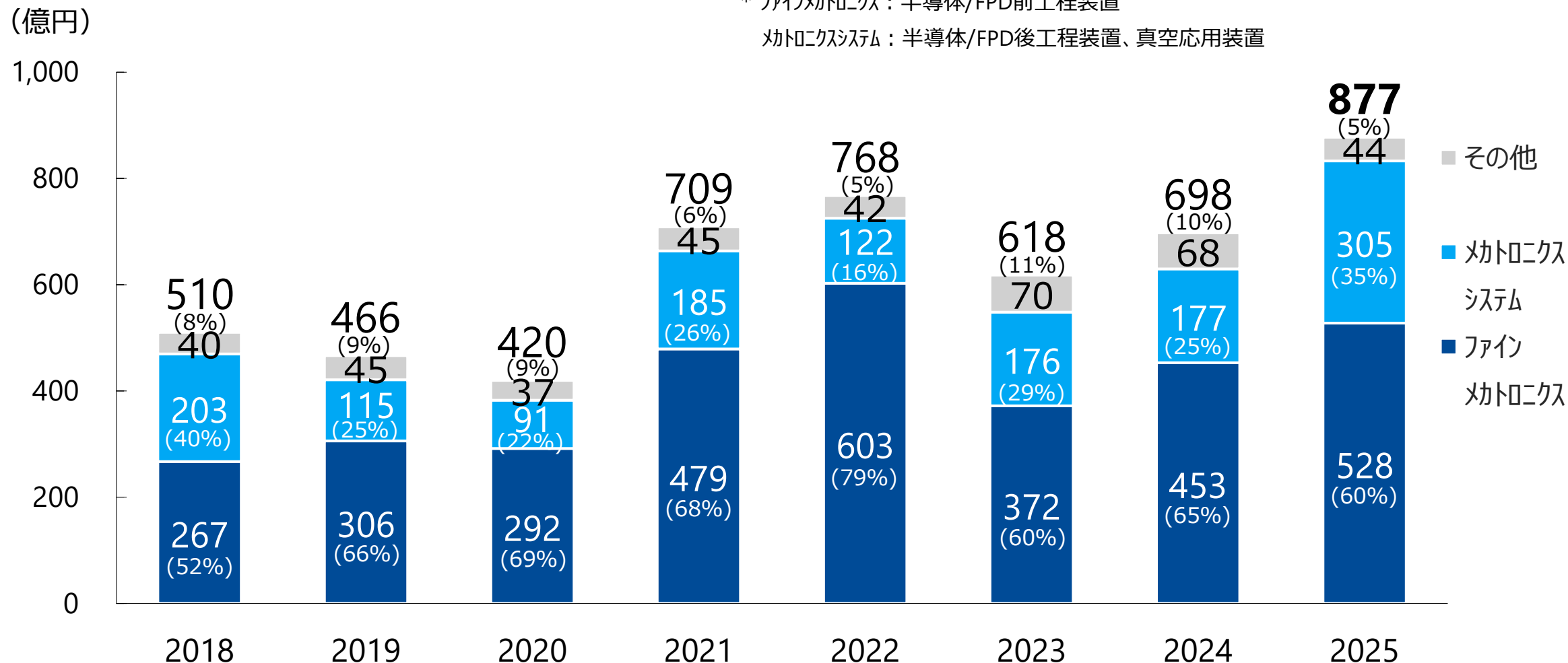


セグメント別受注高

半導体前工程のロジック/ファウンドリ向け装置が順調、半導体後工程の先端パッケージ向け装置が好調に推移

* ファインマイクロ：半導体/FPD前工程装置

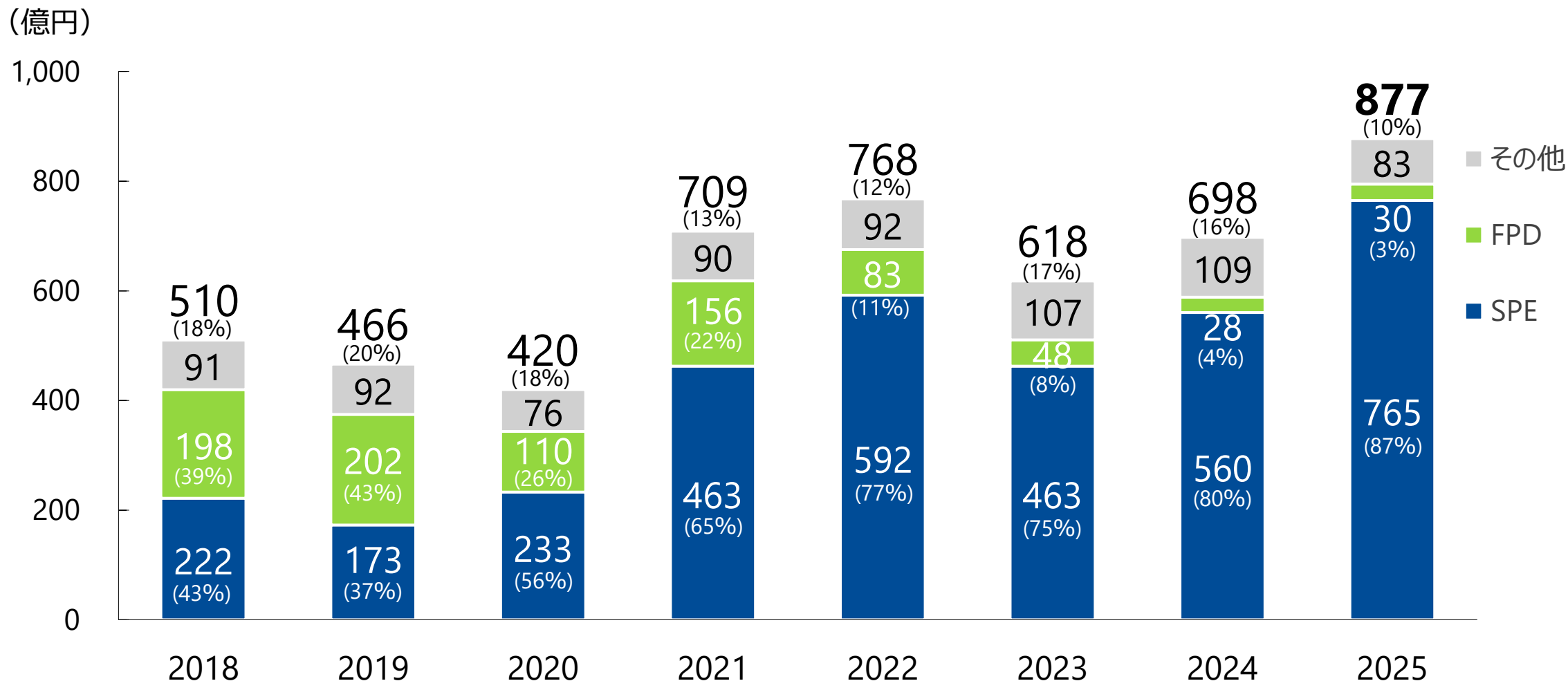
マイクロシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別受注高

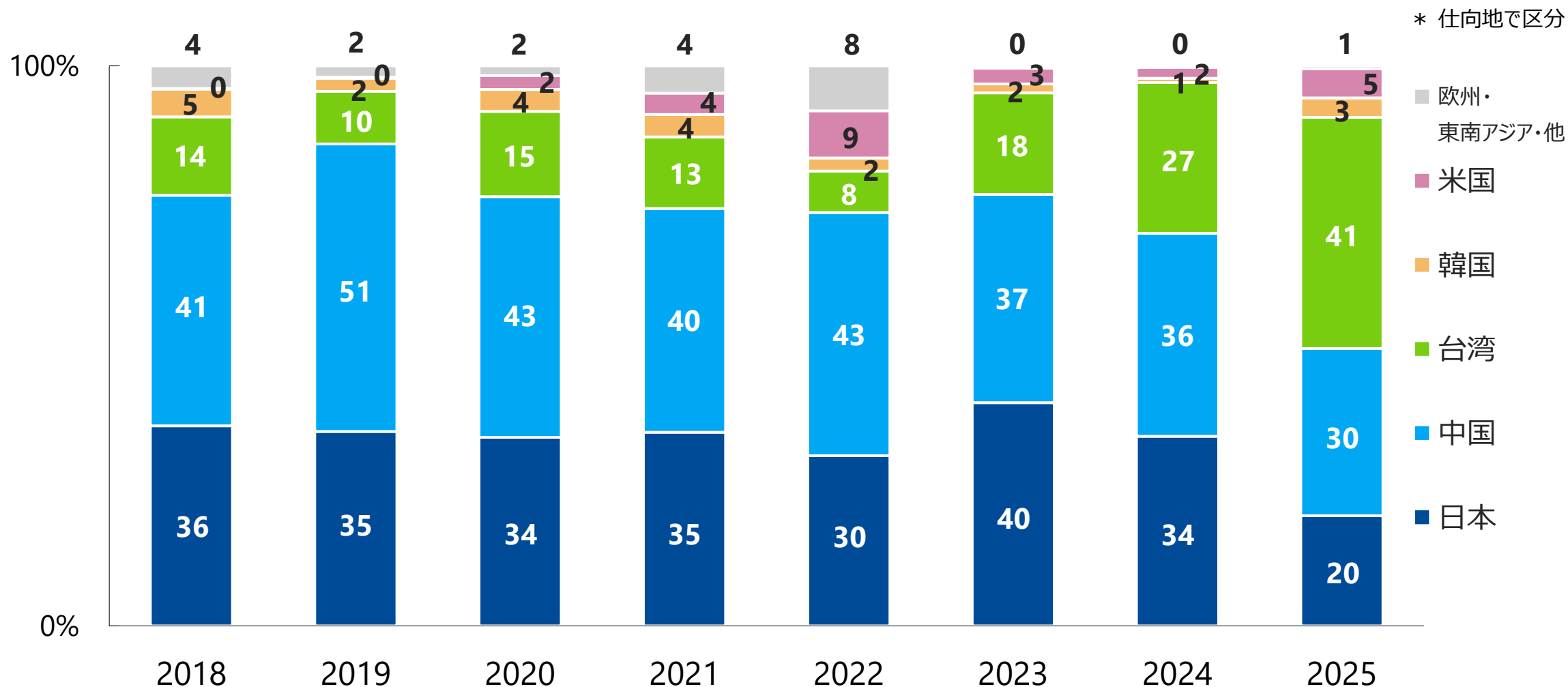
» SPE分野 87%

* SPE：半導体前・後工程装置
FPD：FPD前・後工程装置



地域別受注高比率

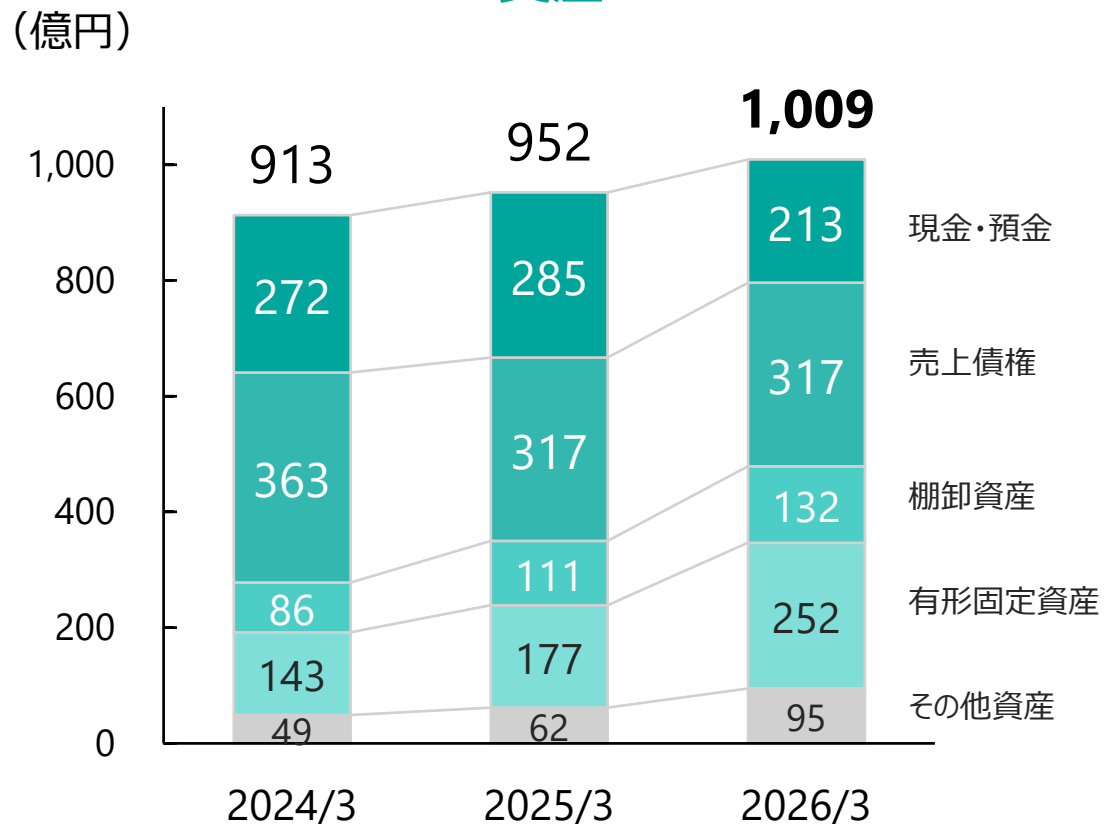
海外向け80%（台湾41%、中国30%）



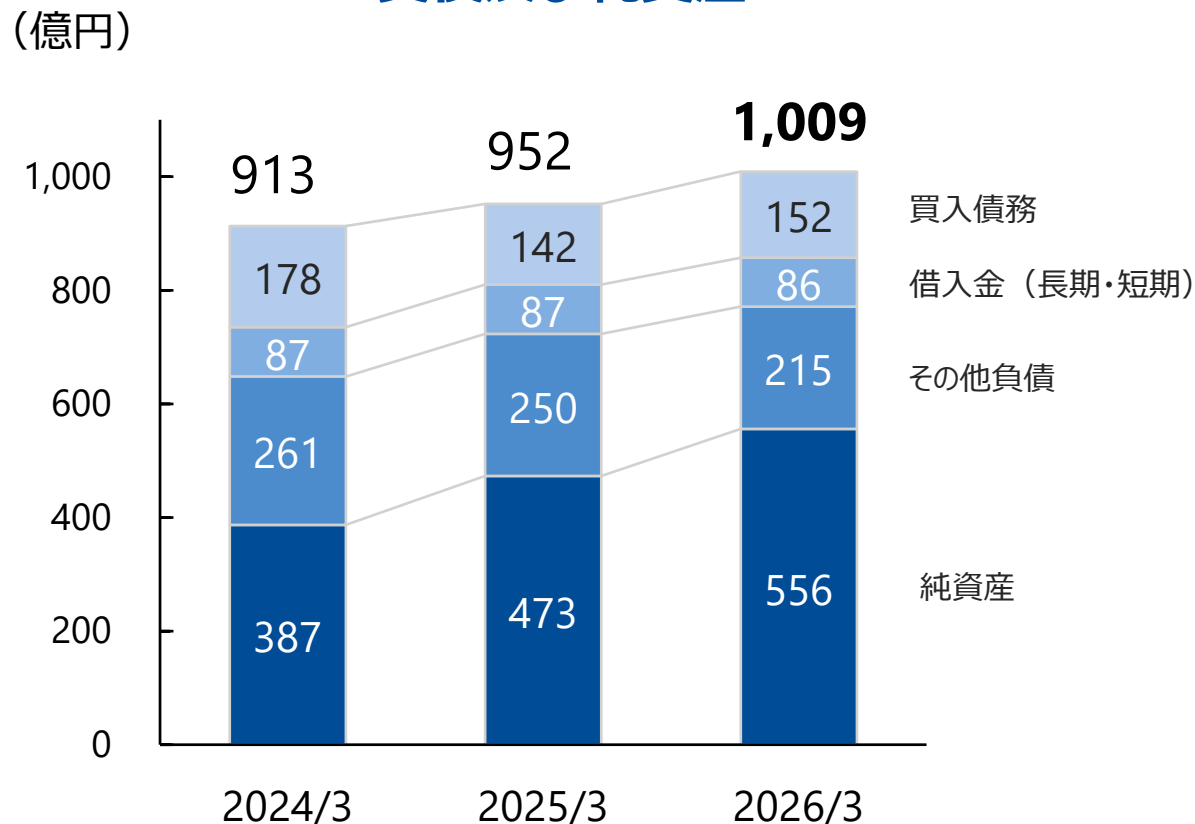
貸借対照表

- 》 自己資本比率 49.7% ('25/3) → 55.1% ('26/3)
- 》 D/Eレシオ 0.19倍 ('25/3) → 0.16倍 ('26/3)
- 》 ROE 24.0% ('25/3) → 21.7% ('26/3)

資産



負債及び純資産



02

2027年3月期 連結業績予想

業績予想サマリー

■ 当社の事業環境

- 半導体業界は、生成AI向けの投資継続。ロジック向けの他、メモリ向け設備投資も回復傾向。Siウエーハ製造向け設備投資は回復途上、マスク向けは中国市場で投資継続、パワーデバイス市場は引き続き低調。
- FPD業界は、依然として設備投資が低水準。
- 当社として中長期的な市場拡大と共に成長を目指す。ただし、半導体輸出規制、世界情勢の不安定化、関税等の地政学的リスクを継続注視。

■ 通期業績予想

- 2026年度 増収増益
売上高 990億円（12.4%増）、営業利益 160億円（4.8%増）、ROS 16.2%（1.1pt減）
成長投資費用として、前年比 約39億円増加見込み（減価償却費 29億円、研究開発費 3億円、人件費 7億円）

■ 配当予想

- 期末配当は64円を予定（配当性向はおおむね35%を目標）

業績予想

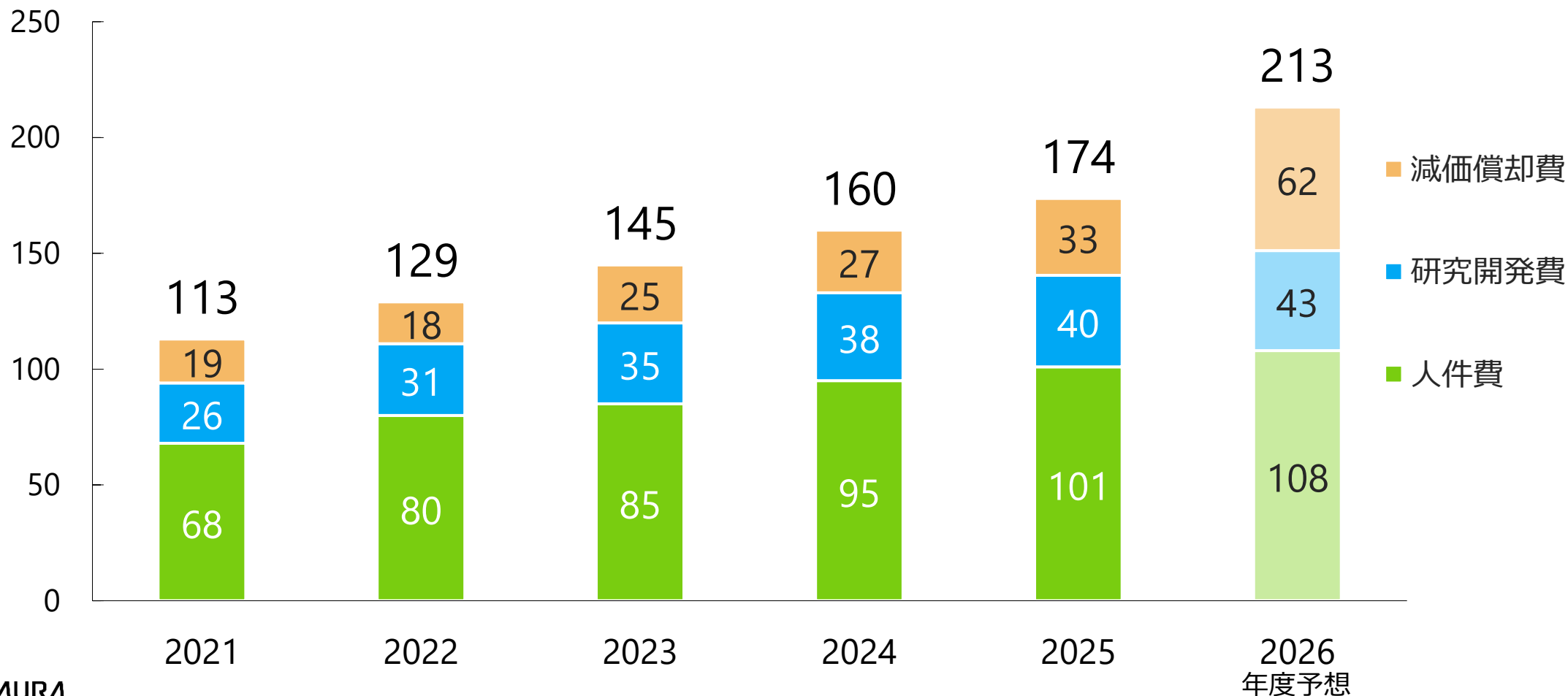
(億円)	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度 予想	対前年 増減率
売上高	610	676	809	880	990	12.4%
営業利益	109	117	141	153	160	4.8%
ROS	17.9%	17.3%	17.5%	17.3%	16.2%	-1.1pt
経常利益	105	116	140	149	157	5.4%
当期純利益	92	88	103	112	119	6.5%
ROE	31.9%	24.5%	24.0%	21.7%	20.2%	-1.5pt
FCF	32	37	38	-35	5	+40億円

成長投資費用予想（計画）

- ≫ 開発評価機や新棟の減価償却費など、成長投資費用は前年比 約39億円増加見込み
- ≫ 顧客の拡大や外部連携、新GNT製品の創出など、投資成果の刈取り、成長加速・拡大に繋げる

(億円)

* 関連ページ：pp. 38-39, 41



配当予想

(円)
100.00

- ▶▶ 期末配当は64円を予定
- ▶▶ 連結配当性向：おおむね35%を目途
(2024年度～)

* グラフは調整後金額

2018年10月
株式併合
(10株→1株)

2023年10月
株式分割
(1株→3株)

2026年3月
株式分割
(1株→5株)

9.33

7.33

7.33

15.33

37.33

40.00

55.60

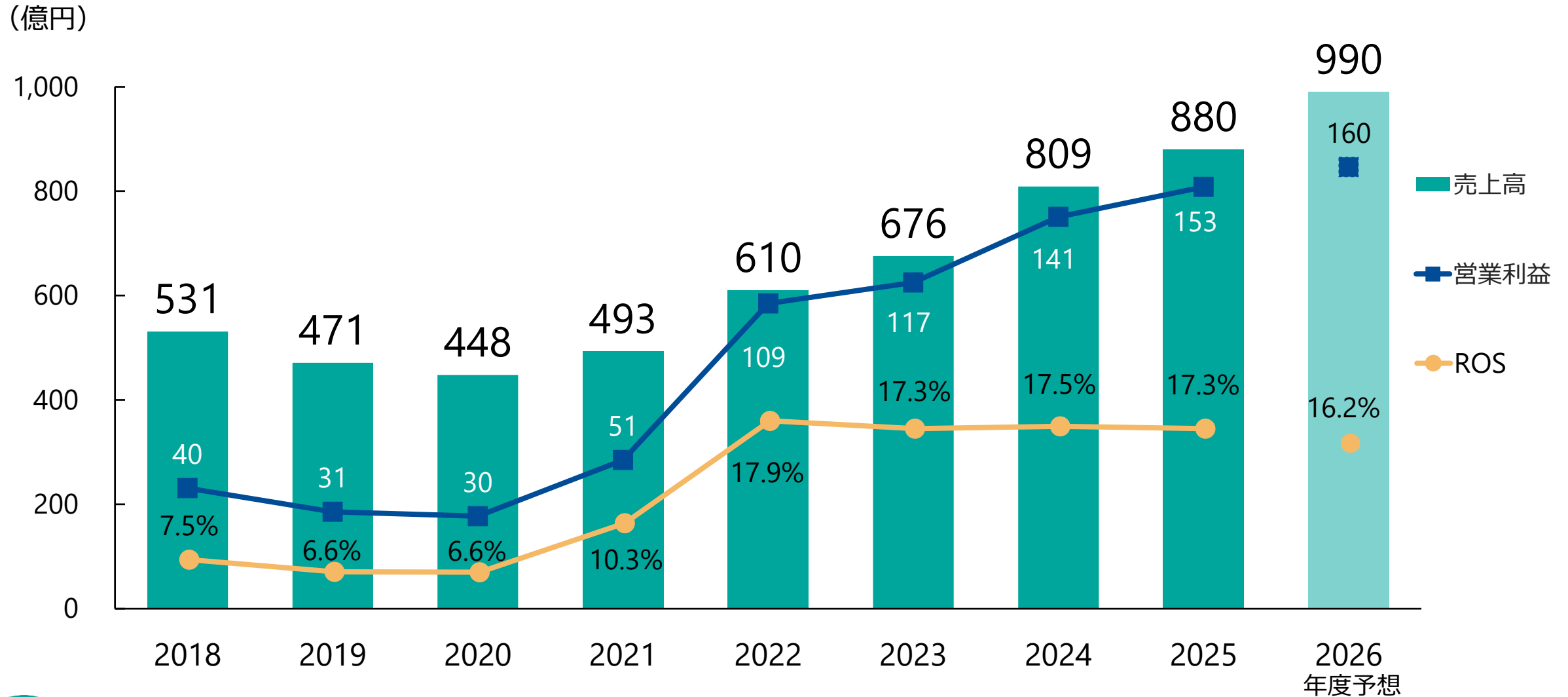
60.00

64.00

年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
年間配当 (調整後)	9.33	7.33	7.33	15.33	37.33	40.00	55.60	60.00	64.00
年間配当 (調整前)	140	110	110	230	560	200	278	300	320
連結配当 性向(%)	24.9	25.0	24.7	34.1	26.9	30.0	35.3	35.2	35.3

売上高・利益・ROS予想

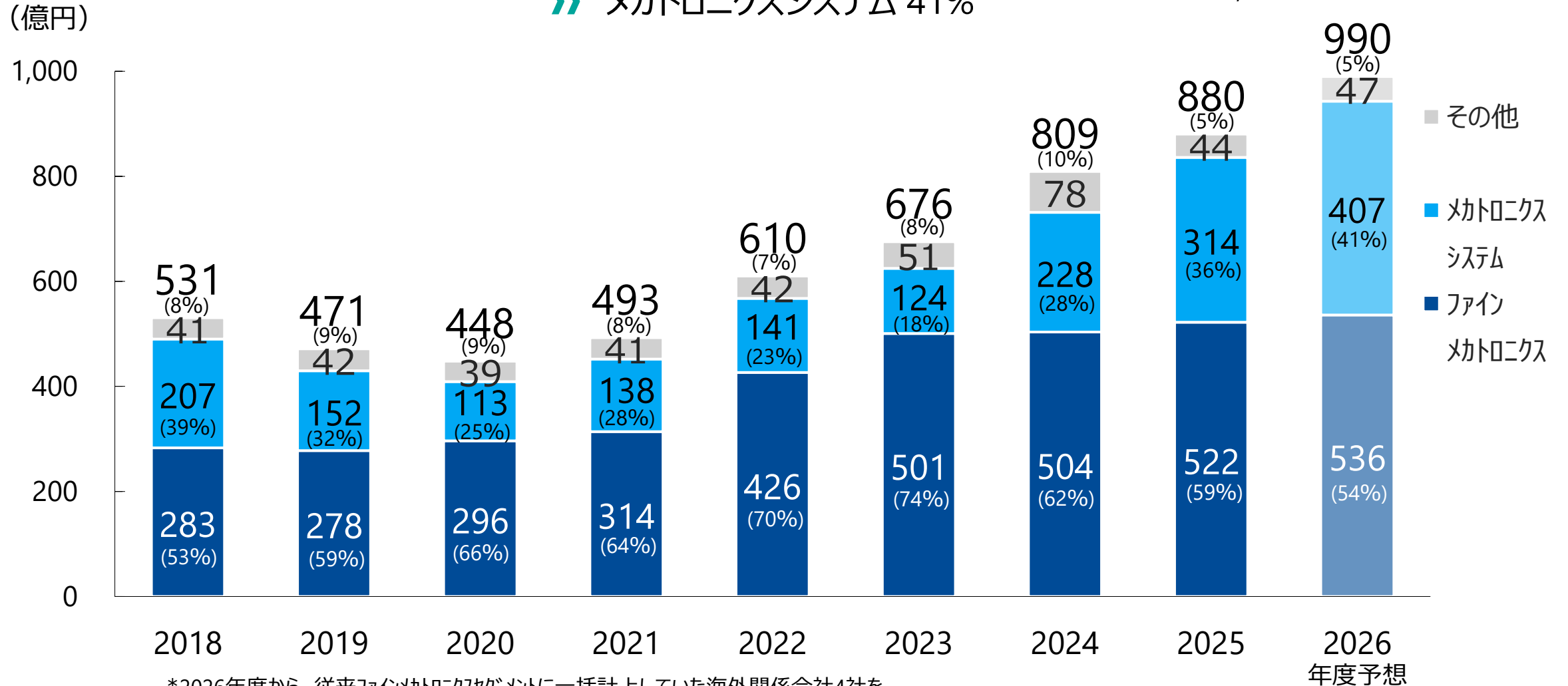
» 成長投資によりROSが一時的に低下



セグメント別売上高予想

- 》 ファインメカトロニクス 54%
- 》 メカトロニクスシステム 41%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

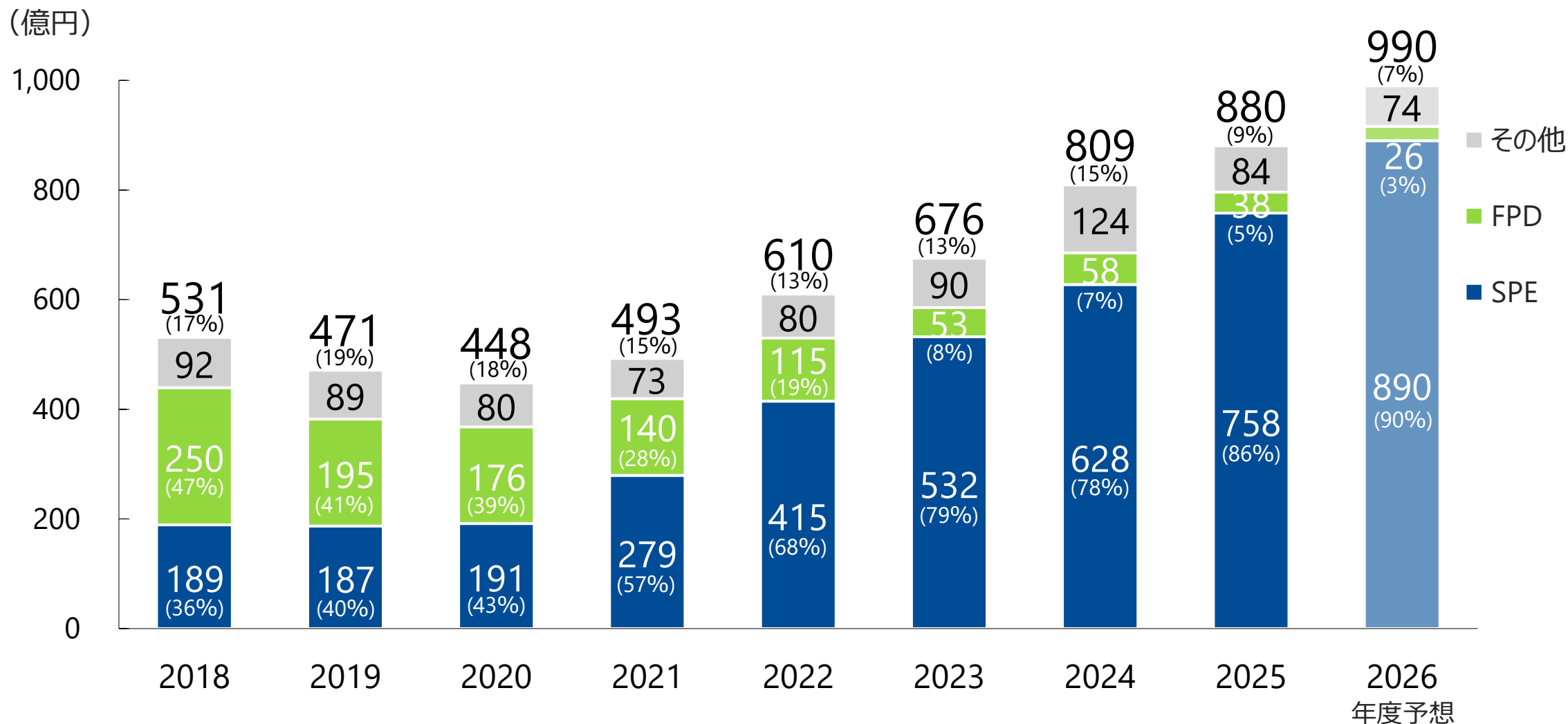


*2026年度から、従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していた海外関係会社4社を、各セグメント由来に区分して計上いたします。2025年度以前については従来の一括計上で表示しております。

分野別売上高予想

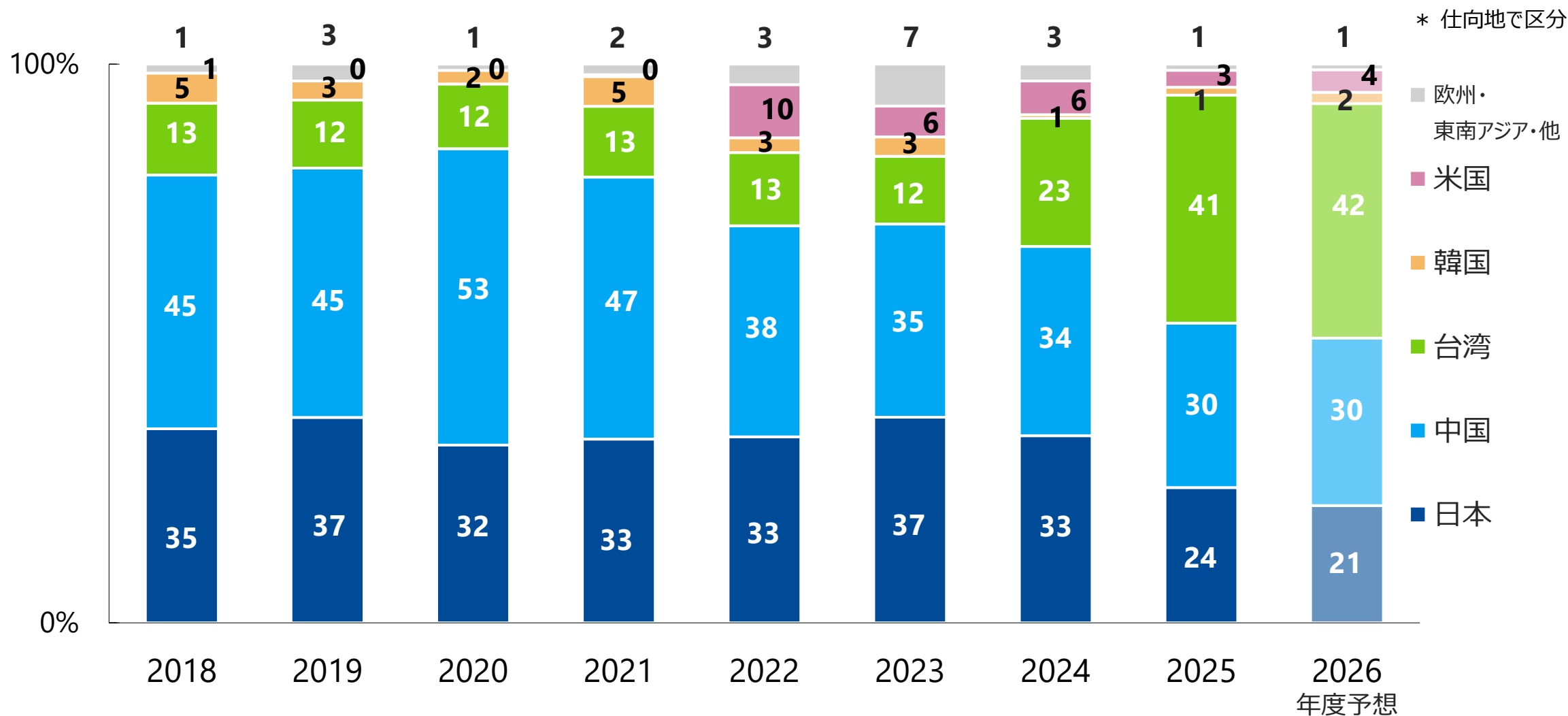
» SPE分野 90%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置



地域別売上高比率予想

海外向け79%（台湾42%、中国30%）



03

新中期経営計画（2026-2028年度）

芝浦ビジョン2033 Phase 1振り返り：業績結果（1）

≫ 連結売上高・ROSはPhase 1（2023-2025）中計値を、前倒ししながら順調に達成

当社として捉える社会変化・課題

市場

- IoT、(Beyond)5G、AIやAR、VRなどデジタル社会の進展に伴う半導体・FPD等市場の拡大

技術

- 先端性の高い半導体の開発・製造
- 技術者の育成、確保

環境

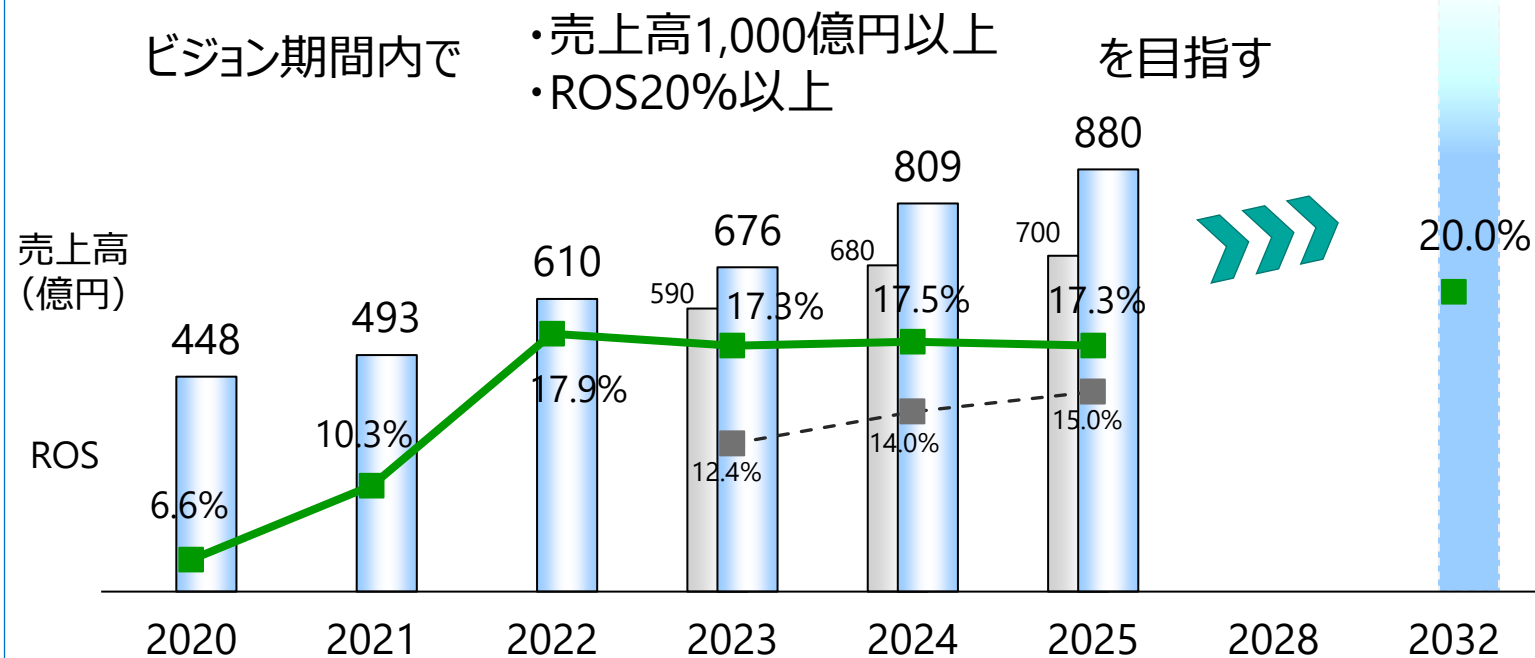
- カーボンニュートラル、環境負荷への配慮
- 資源の有効利用

安定供給

- 半導体需要の高まり・確保、供給力不足
- 求められる機能の多様化、高度化
- 地政学的リスクへの懸念

10年後のありたい姿

**社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業**



※2023～2025年度は、実績値と当初（2023年5月）公表の中計値を併記

芝浦ビジョン2033 Phase 1振り返り：業績結果（2）

» 当初2023年5月公表時点の中計値を上回り、営業利益は4年連続最高益更新

(億円)	実績			中計値 (2023年5月公表)			実績		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
売上高	448	493	610	590	680	700	676	809	880
営業利益	30	51	109	73	95	105	117	141	153
ROS	6.6%	10.3%	17.9%	12.4%	14.0%	15.0%	17.3%	17.5%	17.3%
ROE	9.5%	12.8%	31.9%	15.0%	17.0%	17.0%	24.5%	24.0%	21.7%

芝浦ビジョン2033 Phase 1振り返り：中計値と実績

» 2023年5月公表時点から市場の変化を経て実績は各年度とも上振れ

2023中計値と実績

2024中計値と実績

2025中計値と実績

受注面 (公表値 非公表)

- 実績618億円
- シリコンウェーハ製造向けで、顧客の設備投資計画の見直しがあり、想定より更に受注規模減少（↓）
- 先端パッケージ向けボンダ需要増（↑）

- 実績698億円
- 枚葉式リン酸エッチング装置の受注が想定より大幅増（↑）
- 先端パッケージ向けボンダの受注が想定より大幅増（↑）

- 実績877億円
- シリコンウェーハ製造向けやパワーデバイス向けの回復が想定より遅れ受注規模減少（↓）
- 枚葉式リン酸エッチング装置や先端パッケージ向けボンダの受注増（↑）

売上面

- 中計値590億円に対し676億円（+15%）
- 半導体前工程の前年度の受注とその後進捗、半導体後工程の受注増が寄与

- 中計値680億円に対し809億円（+19%）
- 主に先端パッケージ向けボンダの受注増が寄与

- 中計値700億円に対し880億円（+26%）
- 特に先端パッケージ向けボンダの受注大幅増や、装置出荷台数増加に伴うサービス関連増収が寄与

営業 利益面

- 中計値73億円に対し117億円（+60%）
- 半導体分野の売上高増（↑）
- 経費減少も寄与（↑）

- 中計値95億円に対し141億円（+49%）
- 半導体分野の売上高増（↑）

- 中計値105億円に対し153億円（+46%）
- 半導体分野、特に後工程及びサービス関係の売上高増（↑）

芝浦ビジョン2033 Phase 1振り返り：ビジョン期間の重点的取組みの結果

▶ ポートフォリオ、技術はPhase 2基本方針に繋げ発展的に継続、経営基盤となる人材、財務は強化に継続注力

※2022年度実績→2025年度実績

ビジョン期間の4つの重点的取組み（2023年5月公表）

Phase 1（2025年度）結果

ポート フォリオ

- SPE：グローバル ニッチトップ(GNT)製品拡大を核に更なる拡大
- FPD：新型・次世代向け製品を拡大

- SPE：売上高415億円68%→758億円86% ※
SPE内GNT271億円65%→545億円72% ※
- FPD：FPDの技術を生かしSPE向け新製品上市
- 真空応用：電子部品向けに注力も市況が低調
- ヘルスケア：インクジェット錠剤印刷から応用技術開発加速

技術

- 課題・ニーズの把握と、解決に繋がる技術開発、製品・サービスへの展開
- 製品とサービスのより一体的な提案により、全体付加価値向上

- 課題・ニーズ起点の新製品を継続的に上市
- サービス事業拡大：129億円→228億円
- 製品とサービスのより一体的な提案の取組みは継続・加速

人材

- ビジョン達成を担う人材力強化、持続的成長に向けた積極採用
- DX推進を含む業務生産性向上

- 連結正規従業員数1,221名→1,269名 ※
- 「当社が求める人財像」、「人財マネジメントポリシー」、人材KPI設定、これらに基づく人事施策・制度への展開開始
- DX推進部門を立上げ取組み推進、今後も継続・加速

財務

- 成長性と資本効率の両面を意識した、財務規律の堅持
- 事業成長・株主還元を重視した、キャッシュアロケーションの実現

- 自己資本比率40.7% ('23/3) → 55.1% ('26/3)
- 連結配当性向30% → 35% ('25/3月期～)
(調整後金額で1株当たり37.33円→25年度60.00円予想)

芝浦ビジョン2033 Phase 1振り返り：基本方針4つの柱の結果

» SPE分野の更なる拡大や持続的成長に向けた投資を計画どおり実施し、次の成長へつなげる結果となった

芝浦ビジョン2033 Phase 1：2023-2025

※発注・製造着手ベース

Phase 1結果

4
つ
の
柱

① SPE分野の更なる拡大

- 前工程：複数の新規顧客から受注、Phase 2展開の足掛かり獲得
- 後工程：注力機種がAI関連市場を捉え急拡大
- サービス関連も含めSPE分野が9割近くへ上昇

② 持続的成長に向けた投資

- 研究開発費・研究開発設備：3年間で200億円→前倒し含め231億円※
- 人材：新卒・キャリア積極採用、教育・育成強化、処遇見直し実施

③ 課題とニーズの把握

- 課題やニーズ起点のニッチトップ製品の開発・上市を継続的に実施
- 課題やニーズを全社的に捉える仕組み・サービス事業拡大の基盤づくり実施
- サービス事業：2022年度 129億円→2025年度 228億円

④ マテリアリティと連動した サステナビリティ経営推進

- 長期・短期KPIのもと、各マテリアリティに関する取り組みを実施・継続
- 統合報告書初版2023年9月発行
- 社外ホームページリニューアル、サステナビリティページ充実化

芝浦ビジョン2033 Phase 2（新2026-2028中計）事業環境と当社方針

≫ 事業環境とPhase 1の結果を踏まえ、更なる成長を目指す

	半導体事業環境	当社
市場 顧客	AIの爆発的普及による高成長持続	<ul style="list-style-type: none"> ● AI市場に不可欠なSPEプレーヤーとして業界での地位向上 ● グローバル展開を進める顧客に伴走し、装置提供からサービスサポートにおいても一層必要不可欠なパートナーへ
技術	微細化、パッケージ技術など引き続き進化	<ul style="list-style-type: none"> ● 投資した研究開発設備・環境を活かし、GNT製品を中心に最先端技術に対応する装置の持続的な開発・上市 ● FPDで培った技術・ノウハウをSPE向け装置開発へ展開
リスク	輸出規制強化、原材料・部品の調達面など地政学的リスク	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸出規制関係は継続注視、関係各所との連携継続 ● 部品・部材は、代替品検討、長納期品の計画的確保、標準化による部品点数減などの取組み実施

芝浦ビジョン2033 Phase 2 中計の柱（基本方針）

芝浦ビジョン2033

テーマ

Phase 1 : 2023-2025
土台強化×市場ニーズ把握

「持続的成長に向けた投資」を柱として、次の成長に向けた土台強化を進め**再び営業利益100億円超**を目指す

Phase 2 : 2026-2028
Phase 1 投資成果の刈取り×開発継続

- ・連結売上高1,000億円以上の前倒し達成を目指す
- ・成長投資で利益率低下も、引き続きビジョン期間内でのROS20%以上を目指して取り組む

Phase 3 : 2029-2032
お客様と共に成長

売上高の更なる成長とROS20%以上の達成を目指す

中計の柱（基本方針）

①SPE分野の更なる拡大

ポートフォリオ戦略

①SPEプレーヤーとしての持続的成長 ➡pp. 37-40

②持続的成長に向けた投資

技術・事業開発戦略

②投資成果活用と戦略開発投資の継続 ➡p. 41

③課題とニーズの把握

製品・サービス一体経営（目指すビジネスモデル）

③課題とニーズに応える仕組み・ノウハウの実装・展開 ➡pp. 42-43

④マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進

経営の在り方

④サステナビリティ経営の更なる推進 ➡pp. 44-46

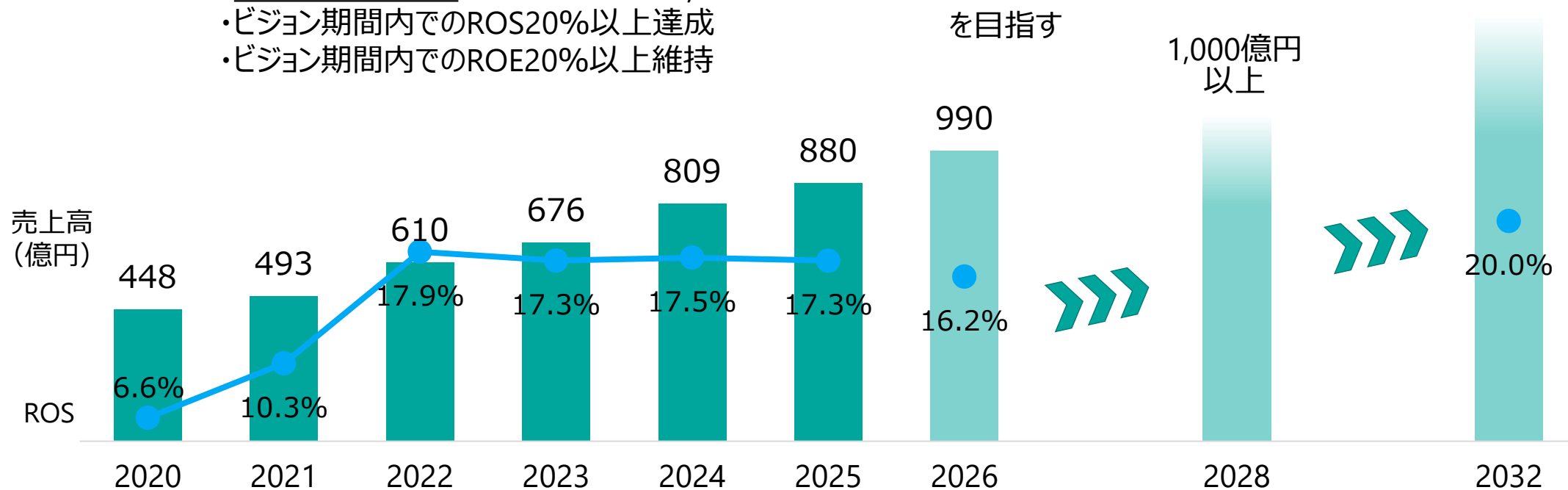
芝浦ビジョン2033 連結売上高目標前倒し

Phase 2期間内に前倒しでの連結売上高1,000億円以上達成を目指す

10年後（2033年3月期時点）のありたい姿

社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業

- Phase 2期間内での連結売上高1,000億円以上達成
- ビジョン期間内でのROS20%以上達成
- ビジョン期間内でのROE20%以上維持

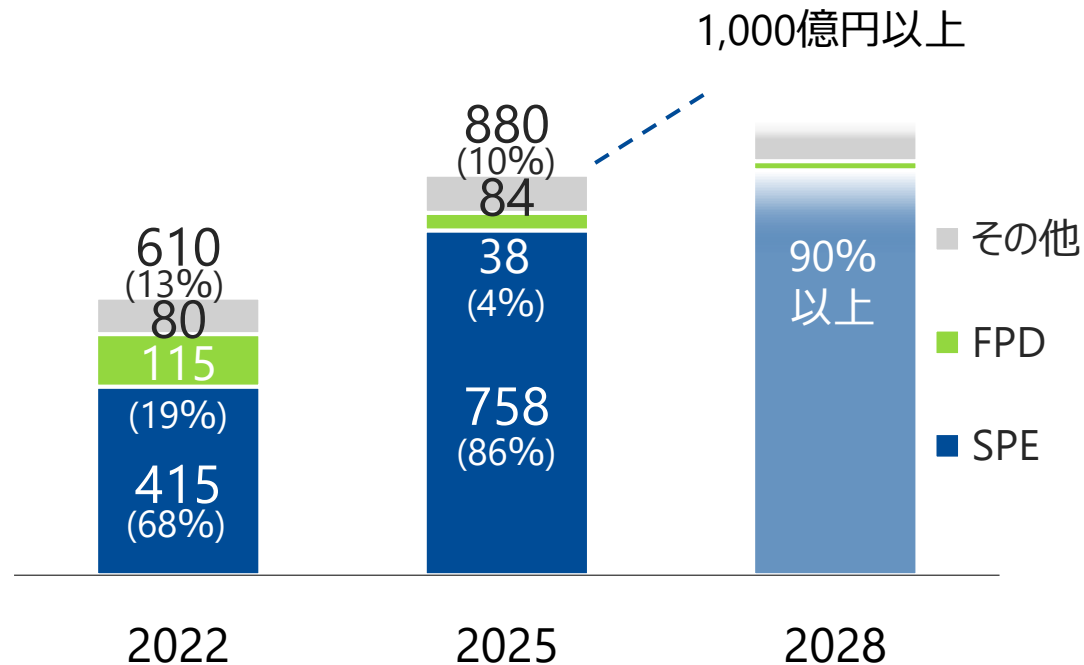


「SPE分野の更なる拡大」から「SPEプレーヤーとしての持続的成長」へ

≫ SPE分野比率拡大は順調に進捗 ➡ GNT製品を武器にしたSPEプレーヤーとして事業の拡大を進める

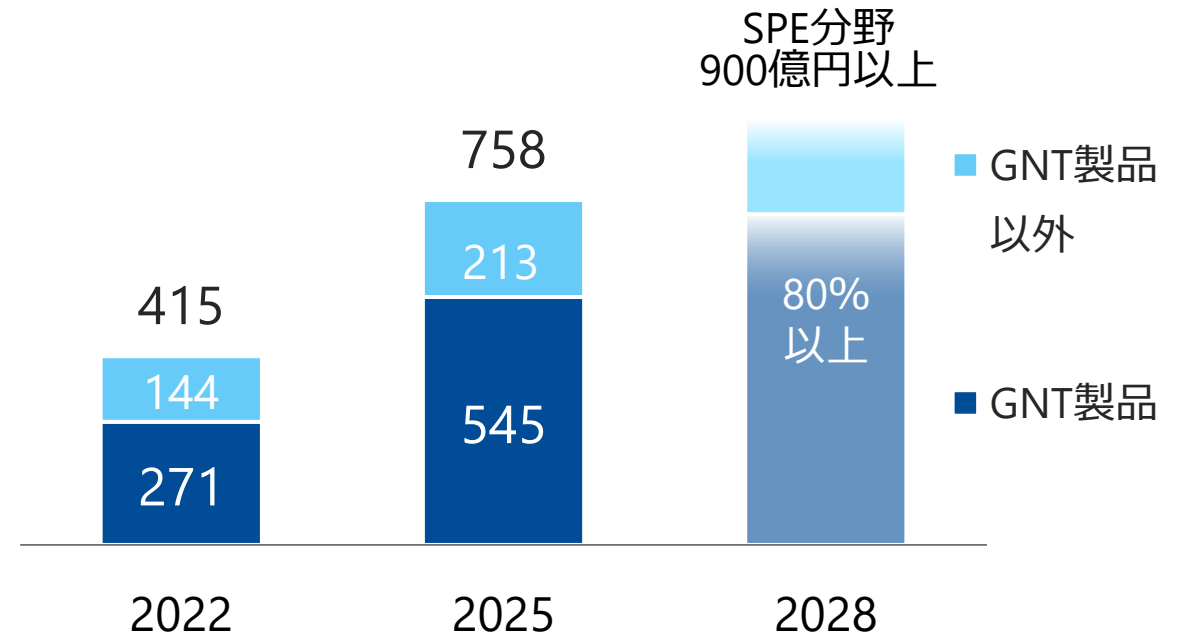
分野別売上高

- › SPE分野 2025年度 758億円86%
 - ➡ 2028年度では規模拡大とともにSPE分野約90%以上を目指す





GNT製品売上高

- › 2025年度 GNT製品売上高545億円72%
 - ➡ 2028年度はSPE分野のうちGNT製品比率80%以上を目指す



GNT工程別製品群 展開方針（前工程）

- ≫ 引き続き4つの工程とともに、注目の中工程向け装置にも注力
- ≫ Phase.1で上市した新しい2製品もGNT製品群に追加

- * いずれも環境調和型製品（掲載機種は一例）
- *  当社グローバル ニッチトップ対象製品群（GNT製品）が属す4工程
-  Phase 2から新しいGNT製品群に追加

 参照：半導体製造装置 前工程

Siウェーハ製造

- ・先端プライムウェーハに対応する洗浄装置開発継続
- ・SiC向け洗浄装置上市準備

Si、SiC、
各材料の
ウェーハ



枚葉式Siウェーハ
洗浄装置

フォトマスク製造

ブランクス、
PSM、
EUVマスク、
次世代EUV
マスク

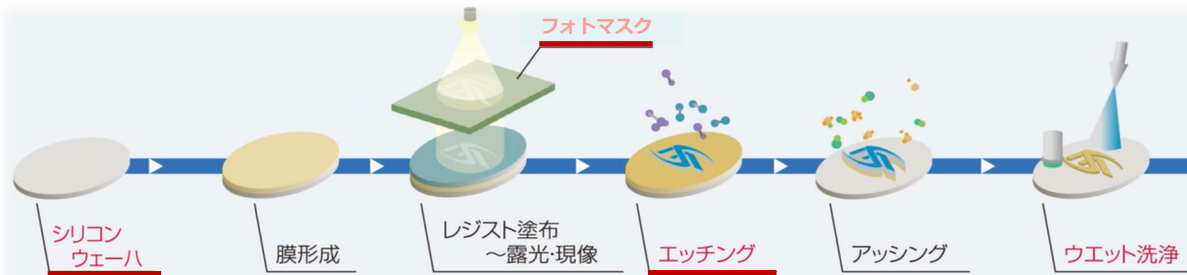
- ・洗浄装置、エッチング装置ともEUV向け機種（高機能）レガシー向け機種（標準）双方のシェア拡大に継続注力



フォトマスク
洗浄装置



フォトマスク
エッチング装置



新しいGNT製品



（中工程向け）パネル用
ウェットスピン装置



FOSB/FOUP
洗浄装置

角型ワーク対応
半導体パッケージ
（2.5D、GPU、
AIチップ）

半導体ウェーハ
出荷用FOSB、
ウェーハプロセス用
FOUP

ウェーハプロセス

ロジック/ファウンドリ
（CPU、GPU等）
メモリ（DRAM）

- ・先端ロジック向け高温リン酸エッチング装置の機能・性能アップに継続注力
- ・適用工程拡大に向けた開発継続
- ・メモリ向け高温リン酸エッチング装置拡販注力



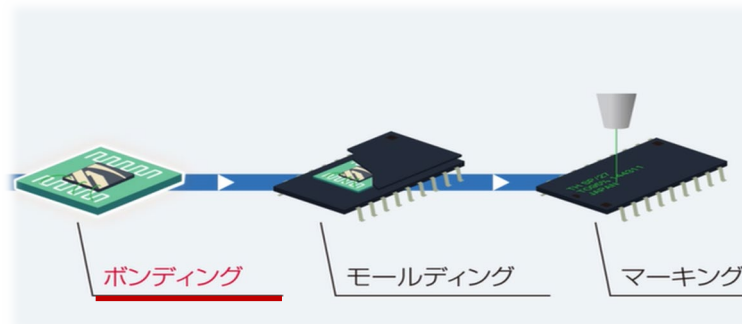
高温リン酸
エッチング装置

GNT工程別製品群 展開方針（後工程）

≫ 注目のボンドは、先端パッケージ向けを中心に多数ラインナップ

ボンディングプロセス

2.5D、チップレット・ハイブリッド等、
各種先端パッケージ技術に対応する機種を
継続開発・投入



ハイエンド2.XD
パッケージボンド
TFC-6500-W

CPU、GPU



- 主力機種として高評価、実績好調
- 接続基板（インターポーザ）の進化に対応した
新型ボンド開発中

ハイエンドウェーハレベル
パッケージボンド
TFC-6600

CPU、GPU、
アプリケーション
プロセッサ




- 主力機種として高評価、実績好調
- 多様なパッケージに対応する優れたオプション機能を
鋭意拡充中

超高精度
ハイブリッドボンド
TFC-6800

ロジック、
イメージセンサ



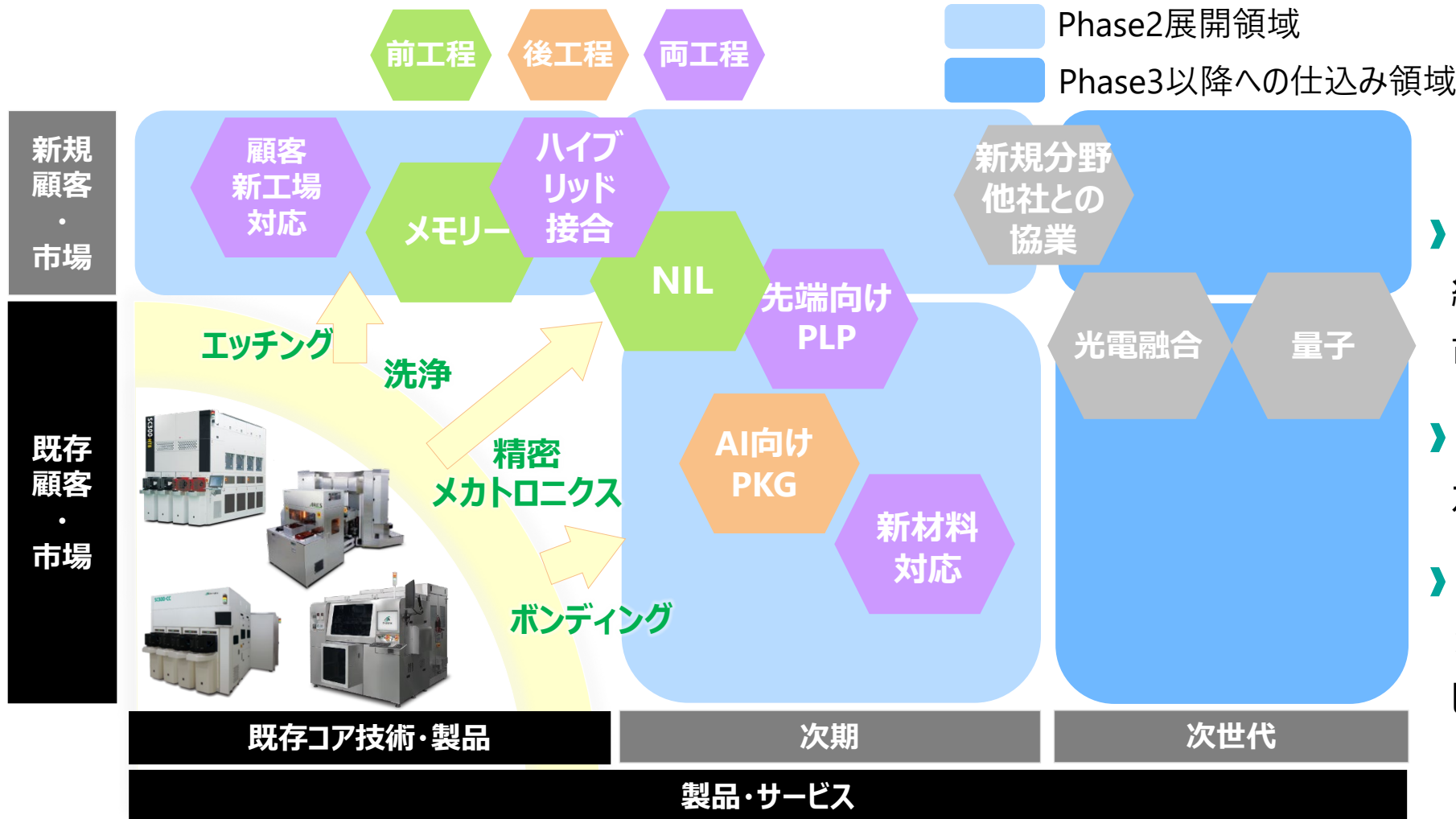
- 従来比 3 倍の高い生産性を実現
- 前処理(洗浄、プラズマ)システムも R & D 評価継続中

- * いずれも環境調和型製品（掲載機種は一例）
- *  当社グローバル ニッチトップ対象製品群（GNT製品）が属す 4 工程

👉 参照：半導体製造装置 後工程

ポートフォリオ戦略：SPE既存領域からの展開方向性

》 既存GNT製品群とそのコア技術を核に、新規顧客・市場や今後期待される領域へ



- 》 成長市場かつ当社の技術と実績が活かせるグローバル・ニッチ市場での持続的拡大を目指す
- 》 先端向け追及継続×既存・レガシー向けリピート
- 》 GNT4工程を中心に、前工程×中工程×後工程×保守サービスで展開

投資成果活用と戦略開発投資の継続（資源配分）

Phase 1 で投資を進めた研究開発設備・評価機を活用し、一層の開発強化・促進を図る

【投資】 Phase 1 主な投資実績

- ▶ 最先端の検査装置・測定器・開発評価機をクリーンルームに配備
- ▶ 顧客への貸出評価機をタイムリーに投入
課題・ニーズを把握

成果の刈取り推進

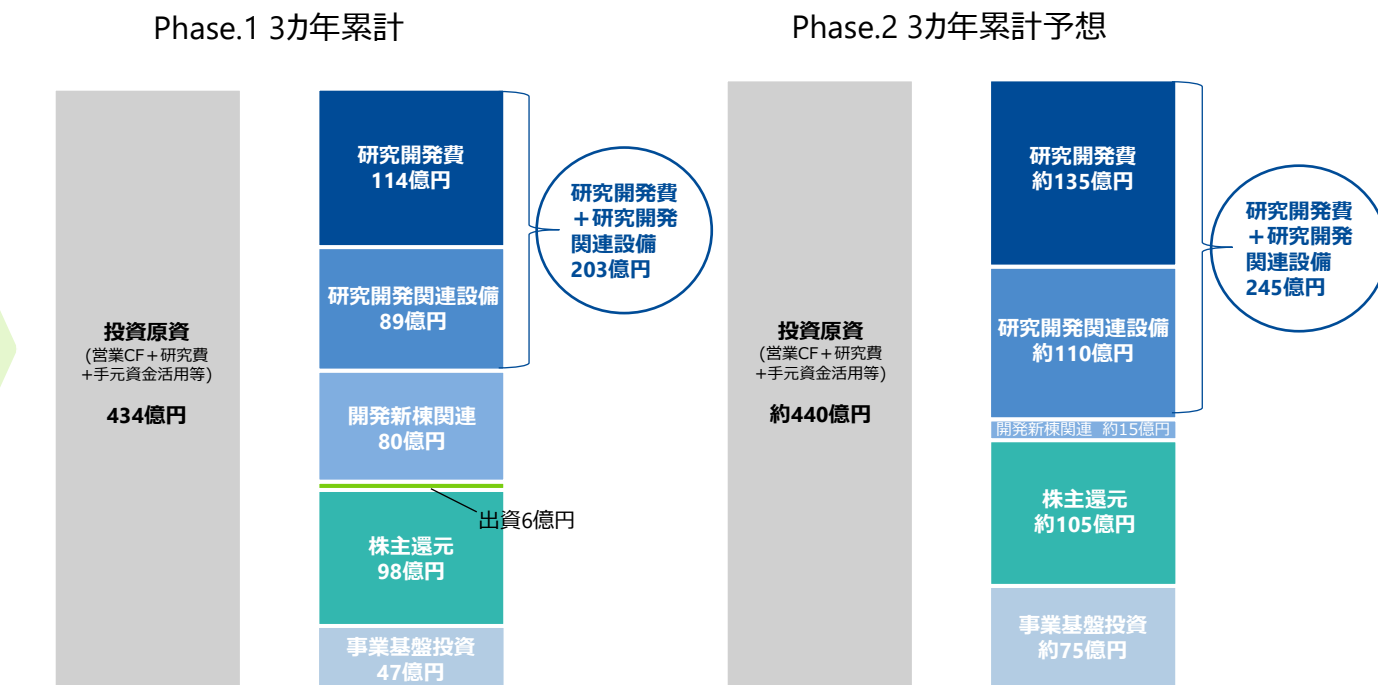
【成果】 Phase 2 での装置開発・上市

- ▶ GNT製品群の機能アップ
- ▶ 新規顧客、新領域に向けた新機種開発・上市
- ▶ 評価を踏まえ受注獲得へ

緩めることなく投資継続

【投資】 更なる成長を目指しPhase 2でも投資継続

キャッシュアロケーション（中計3カ年累計）



ビジネスモデル：製品・サービス一体経営への変革に向けて

- Phase 1では装置出荷台数増加も伴いサービス事業が拡大
- ビジネスモデルの変革を通じさらなる拡大を目指す

*サービス事業売上高：国内外サービス関係会社5社の売上高のうち
部品及び装置サービスに関わる売上の合計

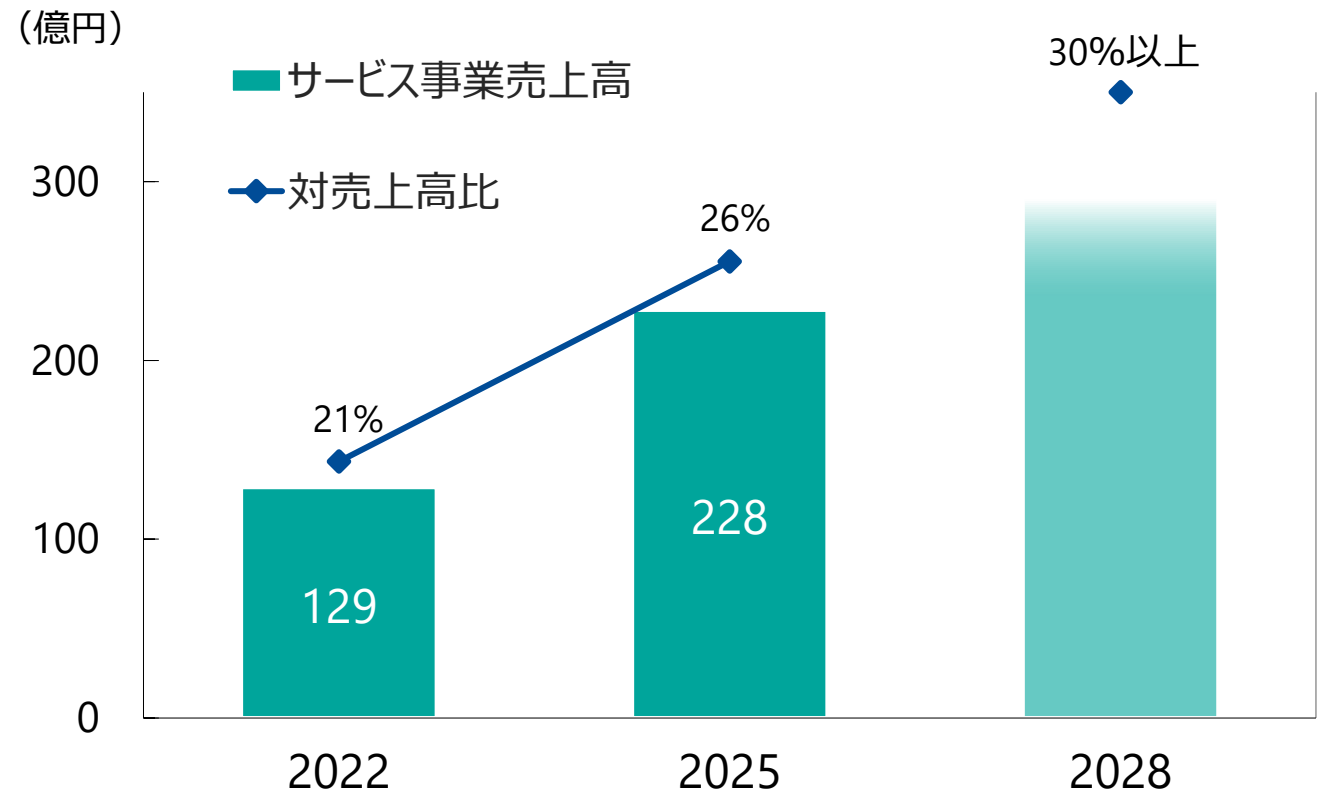
【Phase 1】

- 課題やニーズを全社的に捉える仕組み・サービス事業拡大の基盤づくり
- サービス事業規模拡大

成果を活かし推進継続

【Phase 2】

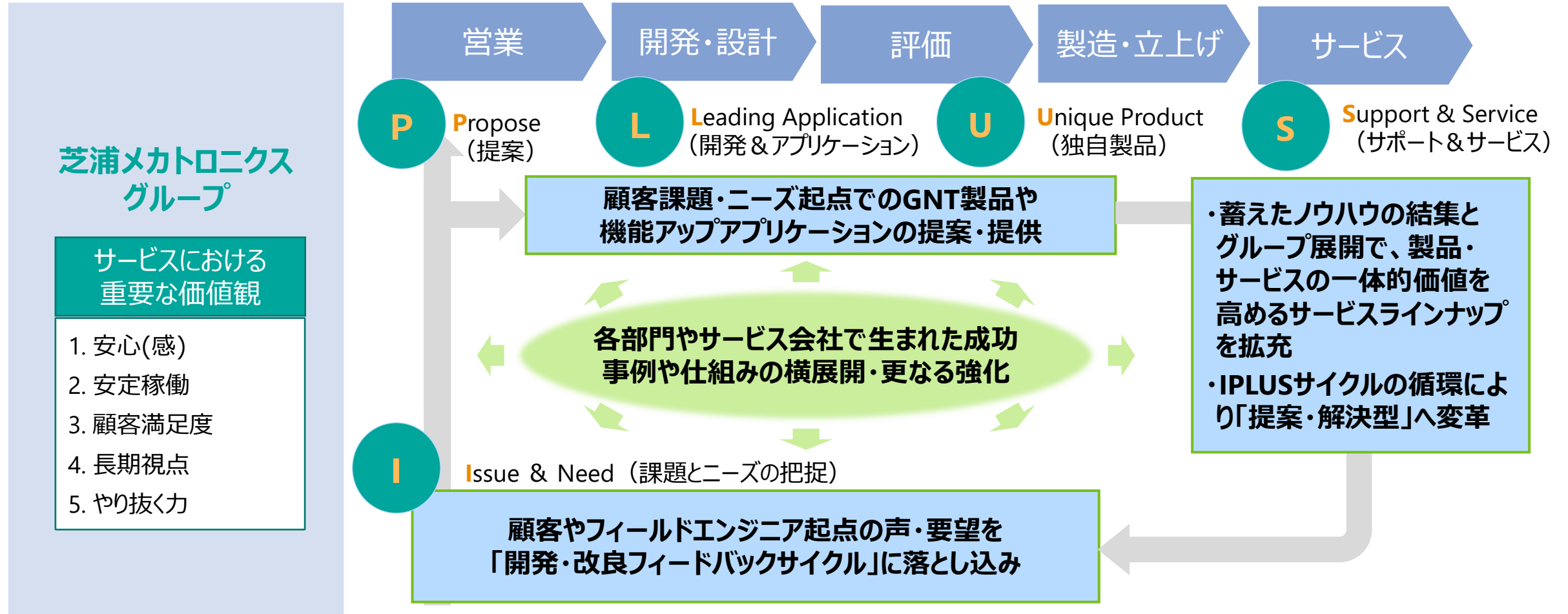
- 製品・サービス一体での提案力強化
 ➡現場の声を開発・設計・改良に活かす
 仕組みとしてIPLUS（アイプラス）サイクルの実践スタートへ
- サービス事業規模の更なる拡大推進



全社の知恵を結集して提案するIPLUSサイクルの実現を目指す

Phase 1で進めたサービス事業拡大の基盤を活かし
グループ全体のフィードバックサイクルに落とし込み、長期的に取り組む

<芝浦メカトロニクスグループ IPLUSサイクル>



2025年度 サステナビリティ関連トピックス

≫ 2025年度の主な実績は以下のとおり

気候変動への対応 環境負荷低減

^{*1}
環境調和型製品の割合
25年度：対売上高92.3%
(目標85%以上)

国内グループCO2排出量^{*2}
25年度：24年度比71.3%削減見込
(2030年度までに2019年度比50%削減)

再資源化率^{*3}
25年度：99.4%見込
(再資源化率99%以上を維持)

多様な人財が活躍できる 環境づくり

- 賃金水準アップ^{*4}
 - ・24年度比5.3%増
 - ・26年4月より新卒(学卒)初任給32.2万円とすることを決定
- 福利厚生制度の充実
 - ・総合福利厚生手当制度の拡充
 - ・団体長期障害所得補償保険 (GLTD) 導入
 - ・出産育児一時金、出産手当金の拡充
 - ・積立NISA制度導入
- 教育・研修の拡充
 - 新教育体系の整備、運用開始
 - 中堅社員、キャリア採用者教育の充実
 - 自己啓発支援強化 (WEB教育導入)

サプライチェーン マネジメントの強化

法令等改正に則し「グリーン調達ガイドライン」禁止物質・管理物質や「パートナーシップ構築宣言」更新、遵守とともに浸透を促進

ガバナンスの強化

経営体制の独立性・多様性の確保

独立社外役員5名 → 6名 (1/2超)
女性役員2名 (22%) → 3名 (30%)

*1: 当社の同種の旧型製品との比較、*2: Scope1+2、*3: 再資源化量/廃棄物発生量、*4: 実績値はいずれも当社単体

事業を通じて展開するマテリアリティ

- ≫ 事業に直結するマテリアリティへの取組みを進め、価値提供と利益創出の積み重ねにより人々の豊かな暮らしの実現と、更なる企業価値向上を目指す

事業を通じて展開するマテリアリティ	中長期計画 ー10年後（2033年）のあるべき姿ー	Phase 1 振り返り	Phase 2 完了時点のイメージ
最先端技術の開発・提供でデジタル社会に貢献	社会変化を見据えた最先端技術の開発・提供により、デジタルを活用したより豊かで創造的な社会を創出	AI市場急拡大に対応・貢献	一層拡大したAI関連市場向け先端パッケージボンダ等、先端向け製品で貢献
研究開発・製造プロセスで産業競争力の維持・向上に貢献	ものづくり人財の育成強化や知的財産の創出とマネジメントの深化により、グローバル展開する企業として産業競争力の維持・向上を実現	持続的成長に向けた積極的投資実施	投資・開発成果と積極的採用・育成により強化した人財により、顧客とのより強固な関係性構築・維持
環境調和型製品の開発・提供でグリーン社会に貢献	エネルギー使用量、原材料使用量を削減する技術・プロセスの開発を進め、当社製品ライフサイクルにおいて環境負荷を低減する製品の開発・提供を推進	新製品は全て環境調和型基準をクリア	環境調和型製品の継続創出により、半導体製造における環境負荷低減に貢献
品質・サービスで顧客の安定稼働・生産性に貢献	製造装置について、グローバルでレジリエントな供給・稼働を実現し続け、顧客の継続的発展が維持されている	リピート受注、サービス事業拡大	IPLUSサイクルの実現・浸透により製品全体の価値向上、顧客とのより強固な関係性構築・維持

価値創出の基盤となるマテリアリティ

≫ サステナビリティを巡る課題への対応としてマテリアリティに落とし込んだ活動により中長期的な企業価値向上へ結び付く取組みへと発展させる

価値創出の基盤となるマテリアリティ	中長期計画 －10年後（2033年）のあるべき姿－	Phase 1 振り返り	Phase 2 完了時点のイメージ
気候変動への対応・ 環境負荷の低減	CO2排出量削減 50%以上（Scope1, 2） （2030年度までに2019年度比） ・廃棄物削減（再資源化率99%以上） ・環境調和型製品 売上高比90%以上	CO2排出量削減に向けた主要施策 の有効性を確認（CPPA導入等） ・再資源化率99%維持 ・環境調和型製品 売上高比率 90%以上継続	成長投資で削減率低下も、 引き続き中長期目標達成を 目指して取り組み推進中 ・再資源化率99%維持継続 ・環境調和型製品 売上高比率 90%以上
多様な人財が活躍 できる環境づくり	・中核人材の登用における多様性確保 （2033年度までに女性管理職10%）	管理職に占める女性の割合 6.4%	管理職に占める女性の割合 8.0%以上
サプライチェーン マネジメントの強化	・信頼関係に根付いたパートナーシップと 開かれた機会の提供	「パートナーシップ構築宣言」の 公表と遵守	信頼に基づく持続的な パートナーシップの形成と、 透明性のある機会の提供
ガバナンスの強化	・高い実効性を備えた取締役会 ・積極的且つ能動的なサステナビリティ経営の 推進	・定期的な実効性評価の実施と 着実な改善 ・サステナビリティ経営体制に従った PDCAの推進	ガバナンス体制の維持・強化

A hand is shown at the bottom, holding a glowing digital globe. The globe is composed of a grid of white dots and is overlaid with a complex network of glowing blue and white circuit lines and nodes. The background is a deep blue with a subtle pattern of white dots.

この先もずっと、
人と技術で
社会を支える。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、

「Smart」、「Solutions」、「Services」の3つの「S」で

お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、

豊かな社会の実現を支えてまいります。

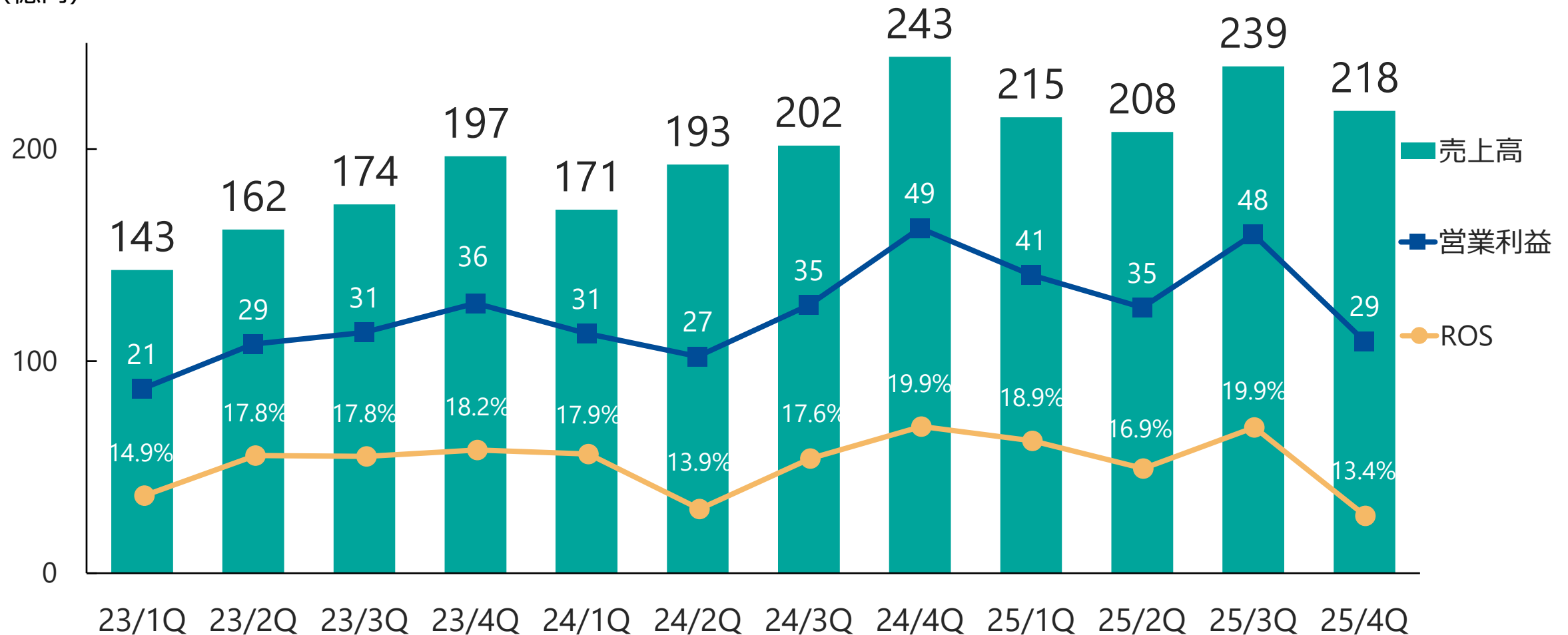
見通しに関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

Appendix

売上高・利益・ROS 四半期推移

(億円)

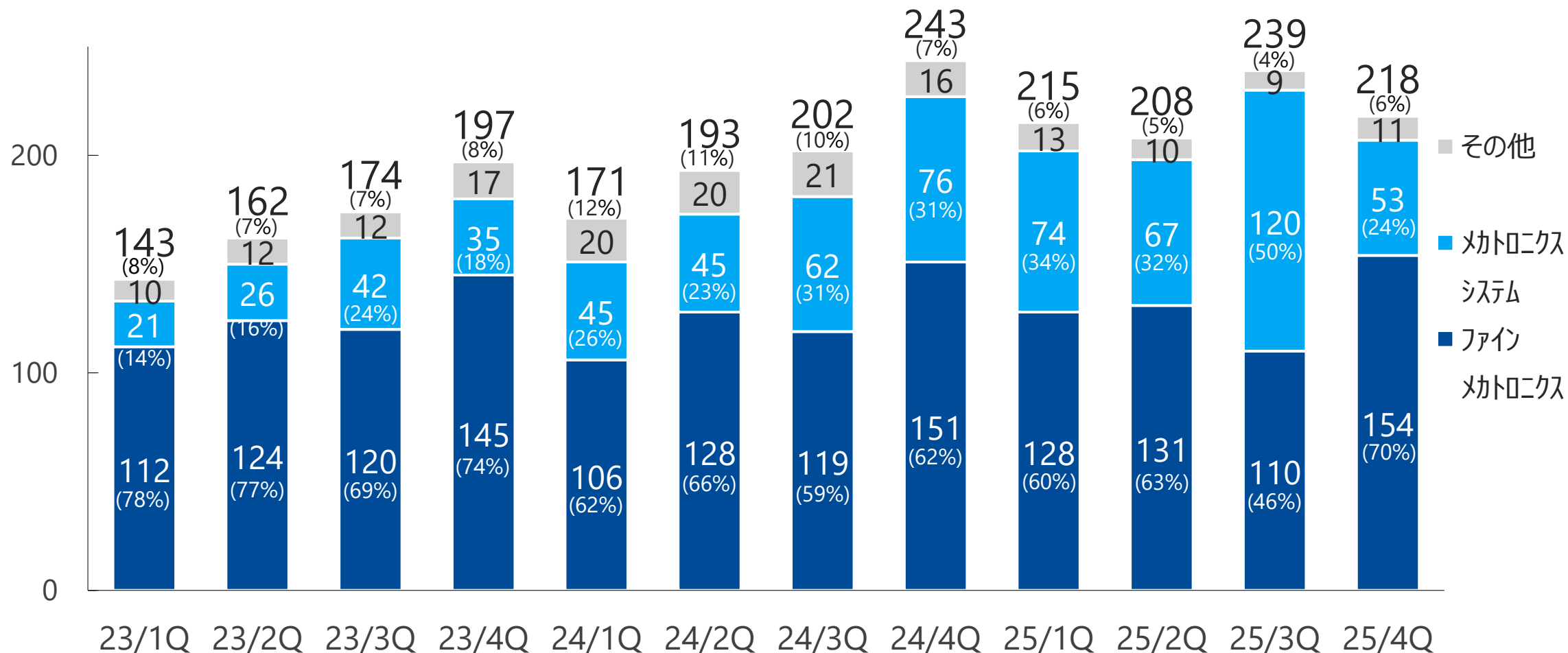


セグメント別売上高 四半期推移

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置

エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

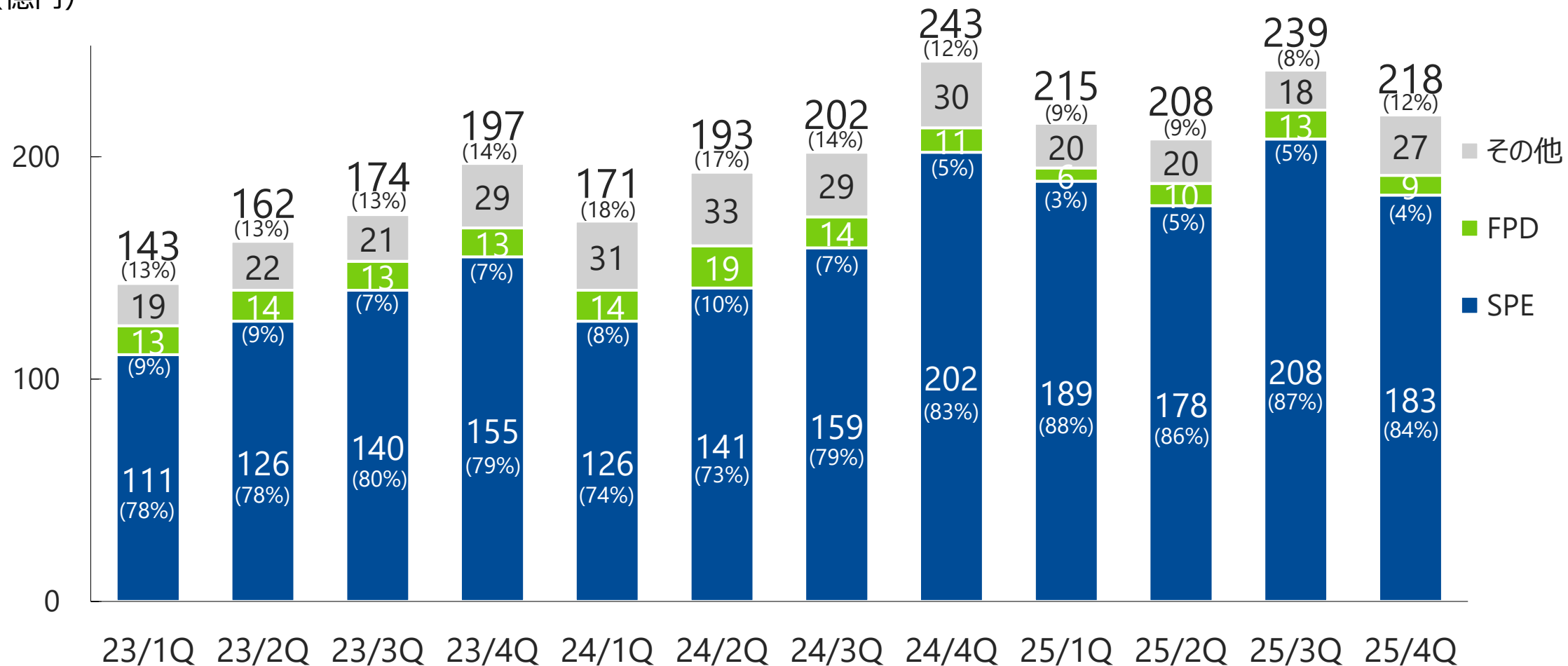
(億円)



分野別売上高 四半期推移

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

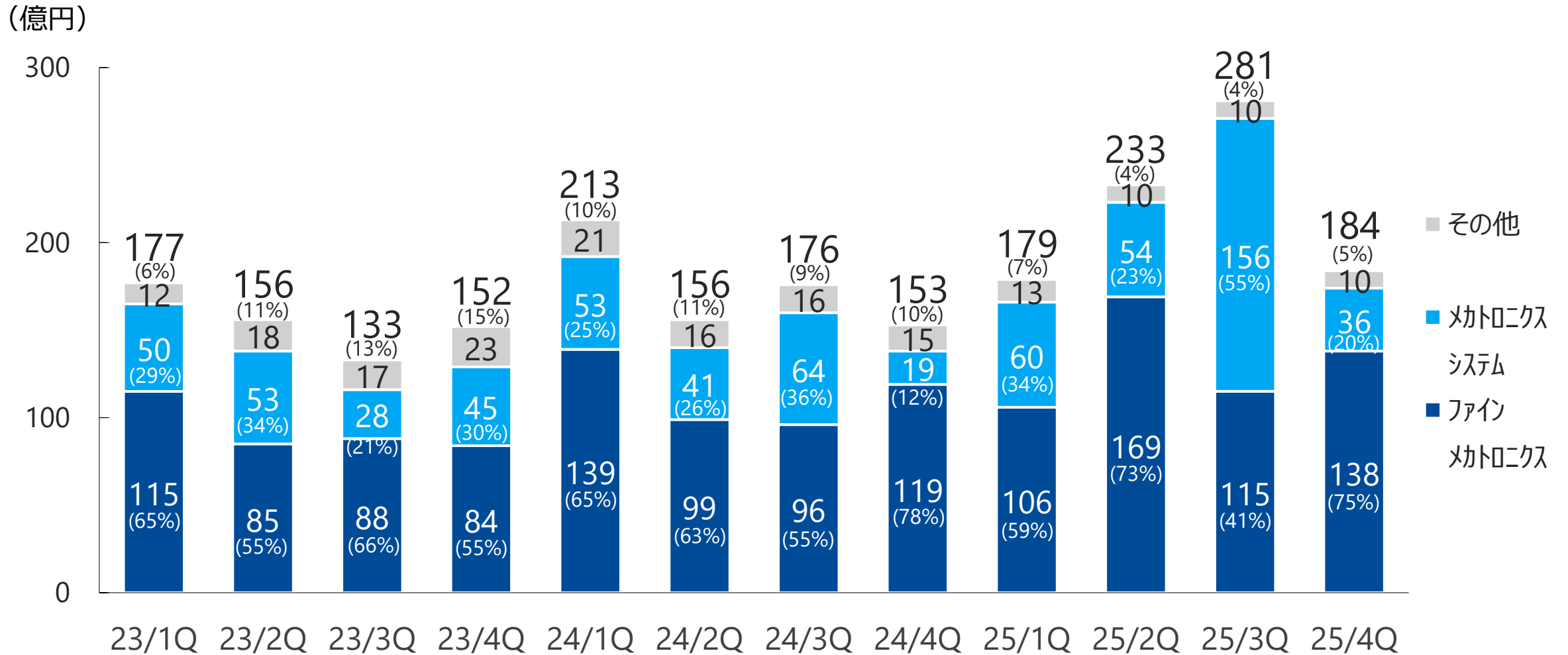
(億円)



セグメント別受注高 四半期推移

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別受注高 四半期推移

